

Содержание

1.	Термины	3
2.	Описание системы управления	4
3.	Функциональная схема модуля ввода / вывода	5
4.	Гальваническая изоляция	7
4.1.	Применяемые компоненты для обеспечения гальванической изоляции	7
4.1.1.	Изолированные DC / DC преобразователи	7
4.1.2.	Преобразователи интерфейса RS-485 со встроенной изоляцией	7
4.1.3.	Изоляция дискретных сигналов высокого напряжения	7
4.1.4.	Изоляция цифровых сигналов	7
5.	Протоколы обмена данными между модулями	8
5.1.	Физический уровень	8
5.1.1.	Формула расчета времени передачи для Raspberry	8
5.2.	Прикладной уровень	8
6.	Протоколы обмена данными между платами внутри модуля	9
6.1.	Протокол SPI	9
6.2.	Протокол I ² C	9
7.	Основные микроэлектронные компоненты	11
7.1.	AD7193 - 24-разрядный Σ - Δ АЦП	11
7.2.	ADS8688	11
7.3.	B2405 - DC / DC преобразователи 24 В / 5 В	11
7.4.	CA-IS3098W - приемопередатчик интерфейса RS-485	12
7.5.	CA-IS3105W - изоляция питания	12
7.6.	CA-IS3741HW - изоляция SPI	12
7.7.	CA-IS3980S - изоляция цифровых входов	12
7.8.	DS3231 - часы реального времени	13
7.9.	MCP23S17/SS - 16-битный расширитель входов / выходов	13
7.10.	TBD62783AFG - матрица из 8 DMOS транзисторов	14
7.11.	Светодиоды серии XL-1606	15
8.	Описание плат	16
8.1.	PM_CPU-RP - контроллер на базе Raspberry Pi	17
8.1.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	17
8.2.	PM_CPU-ESP32_C3	21
8.3.	PM MCU-ESP32_C3	22
8.3.1.	Питание	22
8.3.2.	Микроконтроллер	22
8.3.3.	Загрузка прошивки	23
8.3.4.	Подключение к шине RS-485	23
8.3.5.	Внешний вид платы, схема и спецификация	23
8.4.	PM_LED-10 - плата с 10 светодиодами	27
8.4.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	27
8.5.	PM_LED-18 - плата с 18 светодиодами	31
8.5.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	31
8.6.	PM_CNV-DI16_sink	35
8.6.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	36
8.7.	PM_CNV-DQ16_src	40

8.7.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	40
8.8.	PM_CNV-RQ8 - плата управления 8 реле	44
8.8.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	44
8.9.	PM_CNV-AI4_RTD - плата аналогового ввода 4 термосопротивлений	48
8.10.	PM_CNV-AI4_TC - плата аналогового ввода 4 термопар	49
8.11.	PM_CNV-AI4_W - плата аналогового ввода 4 тензодатчиков	50
8.11.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	50
8.12.	PM_CNV-AI8_IU - плата аналогового ввода 8 датчиков 0..20 мА или 0..10 В	54
8.12.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	54
8.13.	PM_CNV-AQ - плата аналогового вывода	58
8.14.	PM_HMI-Keyboard	59
8.14.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	59
8.15.	PM_HMI-Touch	63
8.15.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	63
8.16.	PM_DBG-FFC	67
8.16.1.	Внешний вид платы, схема и спецификация	67
9.	Комбинирование плат в модули	71
10.	Габаритные размеры плат	72
	Список использованных источников	74

1. Термины

CMTI Common Mode Transient Immunity - устойчивость к переходным процессам.

I²C Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами.

ESD Electrostatic Discharge - разряд электростатического электричества.

EFT Electrical Fast Transient - кратковременный выброс повышенного напряжения.

FFC Flat flexible cable - плоский гибкий кабель для электрического соединения печатных плат.

LDO Low-dropout regulator - линейный регулятор напряжения с малым падением напряжения

SPI Serial Peripheral Interface - последовательный синхронный стандарт передачи данных для связи между интегральными схемами

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами.

2. Описание системы управления

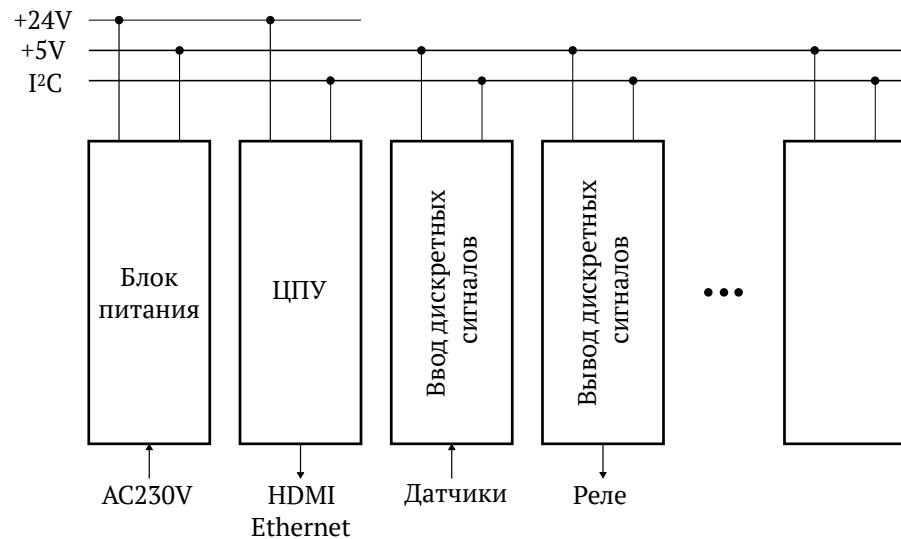


Рис. 1. Концепция модульной системы

Система управления состоит из набора совместимых по подключению и внешним габаритам модулей.

Отдельные модули связаны между собой общей шиной. Шина выполнена в виде стандартного кабеля с двумя витыми парами, обжатого двумя разъемами RJ11. Модули необходимо располагать так, чтобы суммарная длина шины была минимальной. По шине передаётся питание (GND, +5V) и сигналы интерфейса I²C (SDA, SCL).

Каждый модуль на шине имеет свой адрес, который задается DIP-переключателями на каждом модуле. Возможно использование до 8 модулей одного типа.

На данный момент реализованы модули:

Можно дополнительно реализовать:

- Модули аналоговых входов:
 - Тензодатчики
 - Ток 4-20mA
 - Напряжение 0-10V
 - Термосопротивление
 - Термопары
- Модули аналоговых выходов:
 - Ток 4-20mA
 - Напряжение 0-10V
- Модуль с аккумуляторными батареями
- Модуль управления RGB светодиодными лентами

3. Функциональная схема модуля ввода / вывода

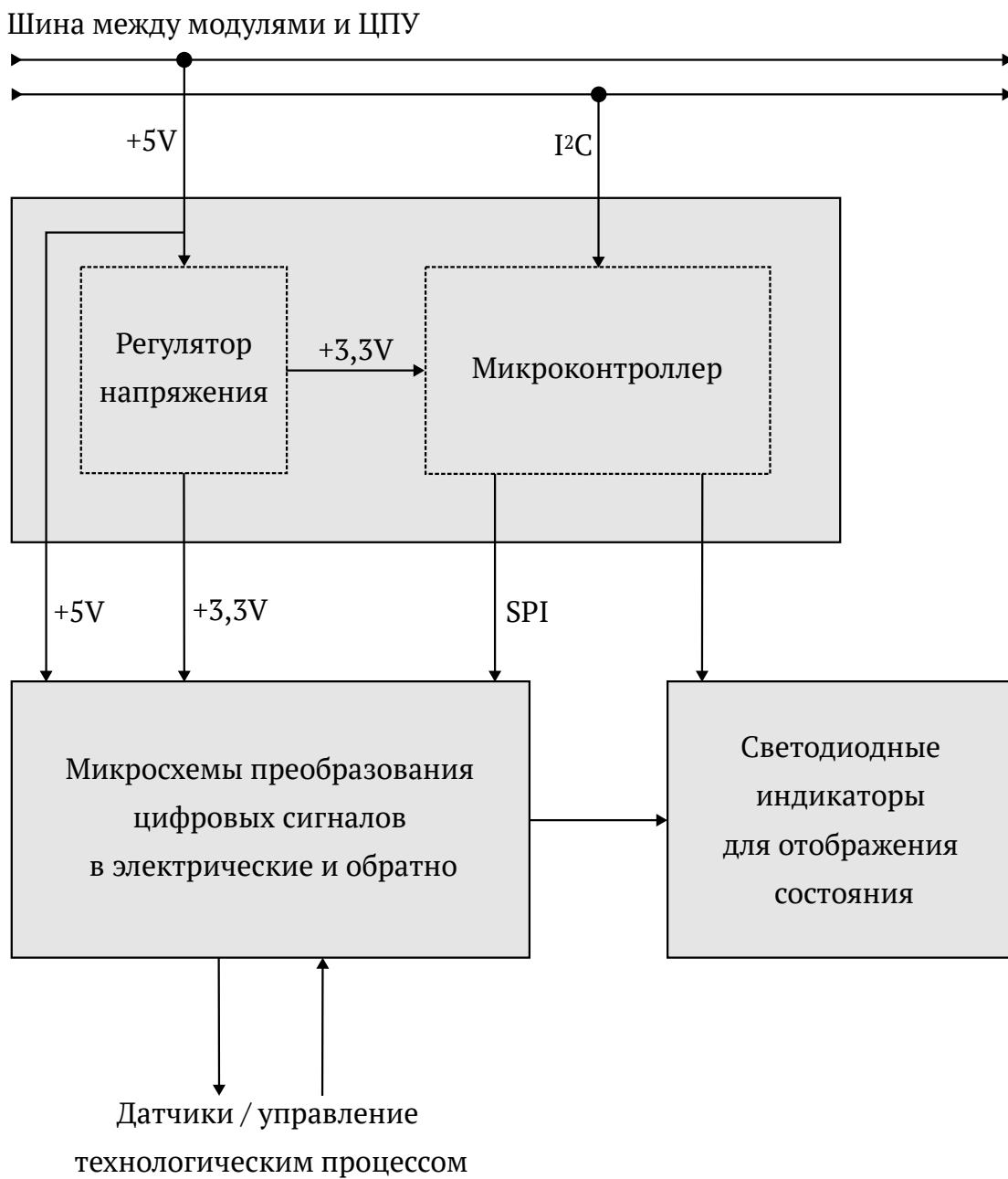


Рис. 2. Функциональная схема модуля ввода / вывода

Модуль состоит из трех функциональных частей, выполненных на отдельных платах.

Основная плата

Основная плата с микросхемами преобразования цифровых сигналов в электрические и обратно. Для разных модулей ввода / вывода данная плата отличается.

Плата с микроконтроллером

Вспомогательная плата с микроконтроллером и регулятором напряжения. Данная плата унифицирована для всех модулей. Микроконтроллер по интерфейсу I²C подключается к ЦПУ и по интерфейсу SPI управляет вспомогательными микросхемами.

Поскольку у каждого устройства на шине I²C должен быть уникальный адрес, на плате есть трехпозиционный DIP-переключатель для задания адреса конкретного модуля. Таким образом, можно использовать до 8 модулей одного типа.

В качестве микроконтроллера используется чип ESP32-C3. На чипе есть разъем для подключения внешней антенны, что дает возможность использовать беспроводное подключение.

Микроконтроллер программируется с помощью обычного кабеля Micro-USB. На плате выведены кнопки BOOT и EN, для перевода микроконтроллера в режим загрузки.

На плате есть LDO регулятор напряжения с выходом 3,3В.

Подключение к шине выполняется через разъемы RJ11 и кабель с двумя витыми парами.

Подключение к основной плате модуля и плате светодиодов выполняется через 10-пиновые кабели FFC.

Плата со светодиодами

Вспомогательная плата со светодиодами для отображения состояния микроконтроллера и электрических сигналов. В модуле может использоваться одна или две таких платы. Есть версии на 8 и на 16 светодиодов.

4. Гальваническая изоляция

Гальваническая изоляция в модулях ввода / вывода применяется по разным причинам:

- Предотвращает протекание выравнивающего тока из-за разности потенциалов объектов, заземленных на разных шинах [1]. У разных модулей и контроллера независимое подключение к датчикам / исполнительным механизмам.
- Повышает устойчивость к разрядам статического электричества (ESD), кратковременным выбросам повышенного напряжения (EFT) [2].
- Понижение шумов на линиях передачи данных [3].

TODO - Нарисовать схему с областями изоляции.

4.1. Применяемые компоненты для обеспечения гальванической изоляции

4.1.1. Изолированные DC / DC преобразователи

[4]:

4.1.2. Преобразователи интерфейса RS-485 со встроенной изоляцией

4.1.3. Изоляция дискретных сигналов высокого напряжения

4.1.4. Изоляция цифровых сигналов

5. Протоколы обмена данными между модулями

5.1. Физический уровень

RS-485

Выбор скорости - скрины с логанализатора

5.1.1. Формула расчета времени передачи для Raspberry.

TODO - задержка передачи с логанализатора.

$$v_{\text{data}} = v_{\text{uart}} \cdot \frac{\text{data_bits}}{\text{start_bits} + \text{data_bits} + \text{parity_bits} + \text{stop_bits}} \quad (1)$$

Где:

- v_{data} - скорость передачи данных, [бит/с]
- v_{uart} - скорость интерфейса UART, [бод]
- start_bits - количество стартовых бит. Как правило, 1 стартовый бит.
- data_bits - полезные данные. Значение в диапазоне 5 .. 8 бит.
- parity_bits - бит четности. 0 .. 1 бит.
- stop_bits - количество стоповых бит. 1 .. 2 бита.

Расчет времени передачи данных:

$$t = \frac{V_{\text{data}}}{v_{\text{data}}} \quad (2)$$

Где:

- t - время передачи, [с]
- V_{data} - объем данных для передачи, [бит]
- v_{data} - скорость передачи данных, [бит/с]

5.2. Прикладной уровень

Сериализация данных - MessagePack.

Контрольная сумма

Примеры структур обмена данных между модулями

6. Протоколы обмена данными между платами внутри модуля

Наиболее распространенные протоколы обмена между интегральными схемами являются SPI и I²C. Разработанная плата PM MCU-ESP32 C3 позволяет подключать платы конвертирования по обоим протоколам.

6.1. Протокол SPI

За основной протокол связи между платами внутри модуля принят SPI.

На рисунке 3 приведена распиновка разъема FFC для подключения платы микроконтроллера к платам конвертирования.

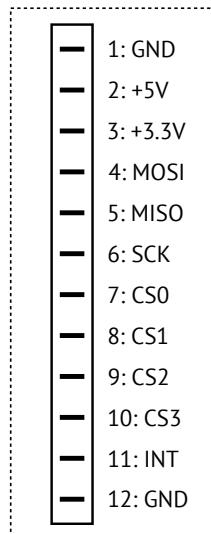


Рис. 3. Распиновка коннектора протокола SPI

Функции пинов:

- +5V - питание ведущих устройств напряжением +5 В.
- +3.3V - питание ведущих устройств напряжением +3,3 В.
- MOSI (Master Out Slave In) - передача данных от ведущего к ведомому
- MISO (Master In Slave Out) - передача данных от ведомого к ведущему
- SCK (Serial Clock) - передача тактового сигнала
- CS0 .. CS3 (Chip Select) - выбор микросхемы. 4 сигнала дают возможность подключать до 4 чипов через один коннектор.
- INT (Interrupt) - сигнал прерывания. Передается от ведущего устройства к ведомому при наступлении каких-то заданных событий.
- GND (Ground) - общий потенциал.

6.2. Протокол I²C

На рисунке 4 приведена распиновка разъема FFC для подключения платы микроконтроллера к платам конвертирования.

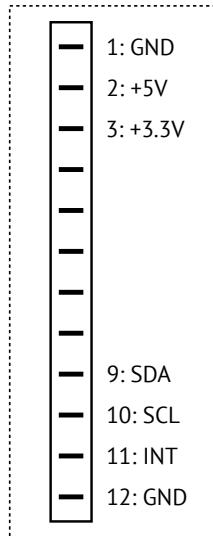


Рис. 4. Распиновка коннектора протокола I²C

Функции пинов:

- +5V - питание ведущих устройств напряжением +5 В.
- +3.3V - питание ведущих устройств напряжением +3,3 В.
- SDA (Serial Data) - передача данных
- SCL (Serial Clock) - передача тактового сигнала
- INT (Interrupt) - сигнал прерывания. Передается от ведущего устройства к ведомому при наступлении каких-то заданных событий.
- GND (Ground) - общий потенциал.

7. Основные микроэлектронные компоненты

Ниже перечислены основные электронные компоненты, которые применяются в платах.

7.1. AD7193 - 24-разрядный $\Sigma - \Delta$ АЦП

АЦП AD7193 компании Analog Devices хорошо подходит для измерения показаний датчиков с небольшим полным диапазоном измерения. Основные характеристики АЦП:

- Тип АЦП - 24-разрядный сигма-дельта ($\Sigma - \Delta$).
- Встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления 1 .. 128. Позволяет измерять напряжения в диапазоне 40 мВ .. 5 В.
- Низкий уровень шумов. До 22 разрядов при низкой частоте дискретизации.
- 4 дифференциальных канала измерения. Автоматический мультиплексор.
- Подключается к микроконтроллеру по интерфейсу SPI.

Функциональная схема показана на рисунке 5.

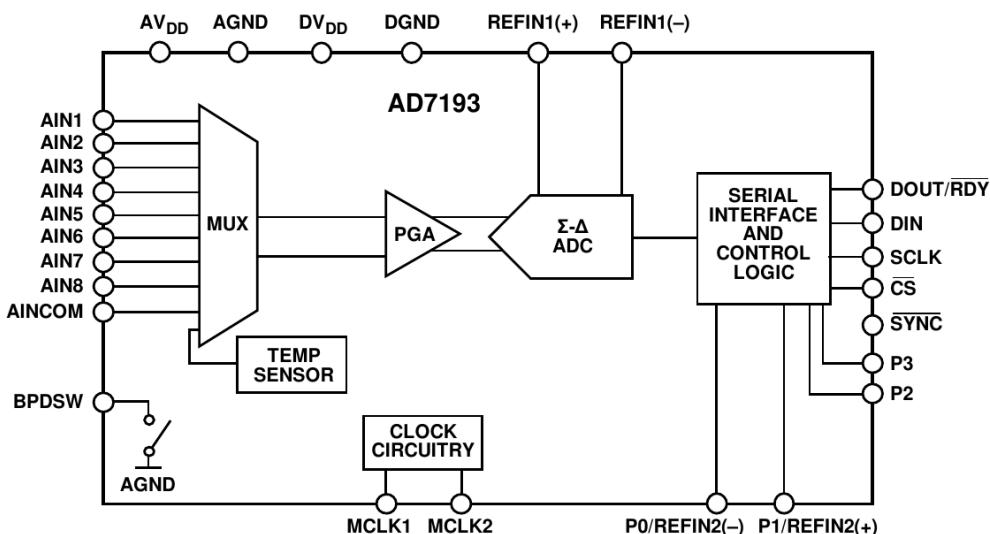


Рис. 5. Функциональная схема АЦП AD7193

Используется в платах:

- PM_CNV-AI4_W
- PM_CNV-AI4_RTD
- PM_CNV-AI4_TC

7.2. ADS8688

7.3. B2405 - DC / DC преобразователи 24 В / 5 В

- B2405LS-1WR3 - мощность 1 Вт
- B2405S-2WR3 - мощность 2 Вт
- B2405S-3WR3 - мощность 3 Вт

Основные характеристики:

Используется в платах:

- PM MCU-ESP32_C3

7.4. CA-IS3098W - приемопередатчик интерфейса RS-485

В микроконтроллерах / мини-компьютерах присутствует интерфейс UART. Для преобразования в протокол RS-485 используются передатчики CA-IS3098W [5] со встроенной гальванической изоляцией.

Основные параметры:

- Скорость передачи - до 20Mbps
- До 256 устройств в одном сегменте сети
- Гальваническая изоляция: $5 \text{ kV}_{\text{RMS}}$ и $\pm 150 \frac{\text{kV}}{\mu\text{s}}$ CMTI
- Защита от короткого замыкания и перегрева

На рисунке 6 показана функциональная схема передатчика.

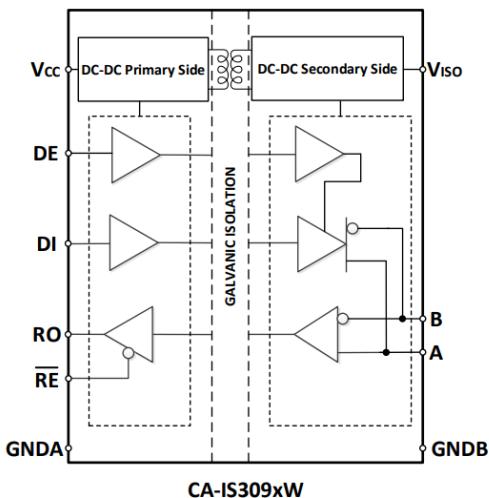


Рис. 6. Функциональная схема передатчика RS-485

Обозначения выводов:

- DE (Driver Output Enable) - Разрешение выходов передатчика
- DI (Driver Input) — Вход передатчика
- RO (Receiver Output) - Выход приемника
- $\overline{\text{RE}}$ (Receiver Output Enable) - Разрешение выхода приемника
- A - Неинвертирующий вход/выход
- B - Инвертирующий вход/выход

Используется в платах:

- PM_CPU-RP
- PM MCU-ESP32_C3

7.5. CA-IS3105W - изоляция питания

7.6. CA-IS3741HW - изоляция SPI

7.7. CA-IS3980S - изоляция цифровых входов

В промышленности для подключения цифровых датчиков наиболее часто применяется постоянное напряжение 24 В, тогда как микроконтроллеры работают, как правило, на напряжении 3,3 В или 5 В.

В данном проекте в качестве изолятора применяется чип CA-IS3980S [6]. Чип обеспечивает изоляцию $2500 V_{RMS}$ и $\pm 300 \frac{kV}{\mu s}$ CMTI. Функциональная схема показана на рисунке 7.

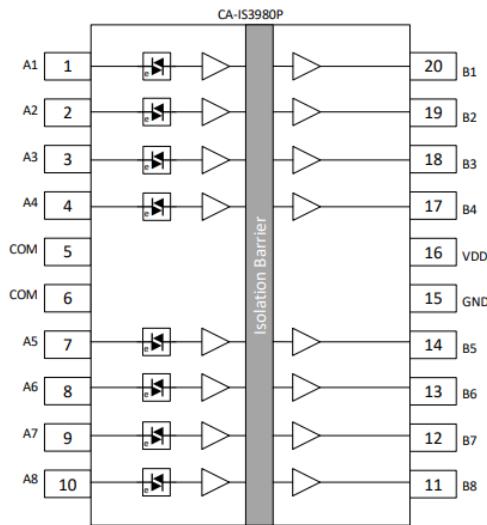


Рис. 7. Функциональная схема изолятора цифровых входов

На рисунке 8 показана упрощенная схема отдельного канала. The internal LED emulator output drives an ON-OFF keying (OOK) modulator, to transfer digital signals across the SiO₂ based isolation barrier between circuits with different power domains. In many applications, this capacitive isolation technology is replacing optocoupler-based solution because it can reduce the power requirements and take up less board space while offering the same isolation capability.

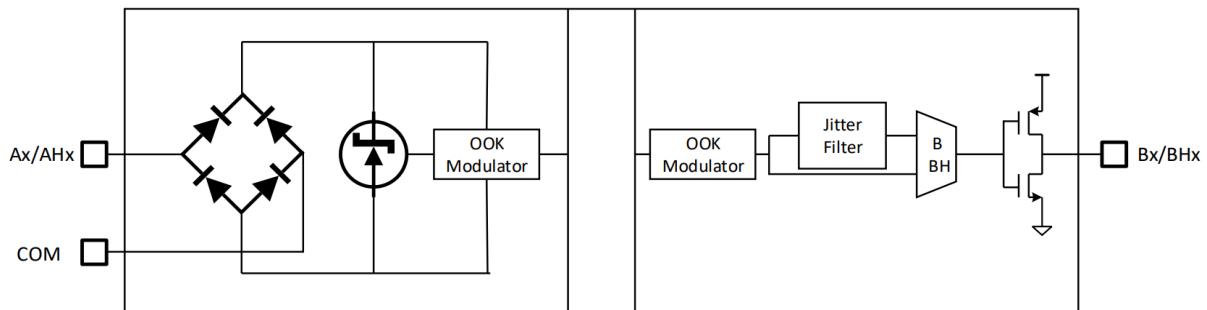


Рис. 8. Упрощенная схема для отдельного канала

On the output side, the signal is either passed directly to the output stage in the case of a high-speed channel (BHx), or the signal is routed through a debounce filter block in the case of a low-speed channel (Bx) for robust operation in industrial environments.

Данный чип применен на плате [PM_CNV-DI16_sink](#).

7.8. DS3231 - часы реального времени

7.9. MCP23S17/SS - 16-битный расширитель входов / выходов

Применяется для опроса состояния входов (на платах входов) и управления выходами (на платах выходов).

Основные характеристики:

- 16 двунаправленных входов / выходов
- Связь с микроконтроллером по протоколу SPI. Есть аналогичная версия с поддержкой протокола I²C.
- Выходы с прерываниями по событию срабатывания входов.

Функциональная схема показана на рисунке 9.

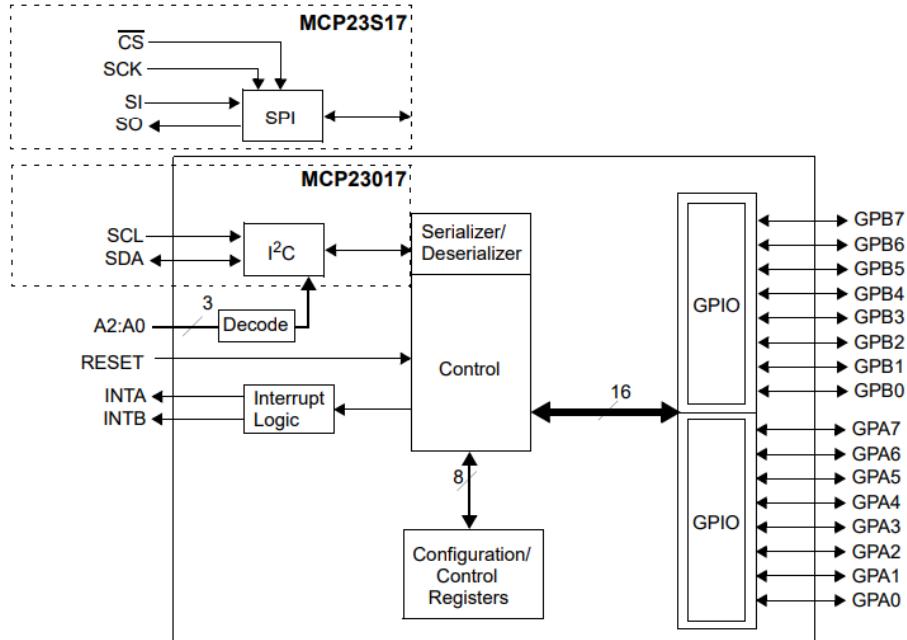


Рис. 9. Упрощенная схема для отдельного канала

Используется в платах:

- [PM_CNV-DI16_sink](#)
- [PM_CNV-DQ16_src](#)
- [PM_CNV-RQ8](#)
- [PM_HMI-Keyboard](#)

7.10. TBD62783AFG - матрица из 8 DMOS транзисторов

Используется для управления силовыми нагрузками, поскольку нагрузочная способность выходов микроконтроллера довольно низкая.

Основные характеристики:

- напряжение питания до 50 В
- выходной ток на каждый канал до 500 мА

На рисунке 10 показана эквивалентная схема для отдельного канала.

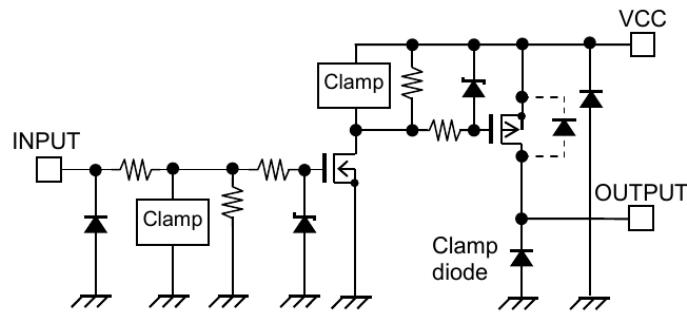


Рис. 10. Эквивалентная схема для отдельного канала

Используется в платах:

- PM_CNV-DQ16_src
- PM_CNV-RQ8

7.11. Светодиоды серии XL-1606

Серия светодиодов бокового свечения компании XinLight. Устанавливаются в посадочное место размера 0602.

Артикул	Цвет
XL-1606UYC	желтый
XL-1606UWC	белый
XL-1606UOC	оранжевый
XL-1606UGC	изумрудно-зеленый
XL-1606UBC	синий
XL-1606SYGC	зеленый
XL-1606SURC	красный

8. Описание плат

ЦПУ	
<u>PM_CPU-RP</u>	ЦПУ на базе мини-компьютера Raspberry Pi или совместимого с ним
<u>PM_CPU-ESP32</u>	ЦПУ на базе микроконтроллера ESP32
Платы микроконтроллеров	
<u>PM MCU-ESP32_C3</u>	Плата на базе микроконтроллера ES32-C3 для работы плат конвертирования и передачи данных на ЦПУ
Платы светодиодов	
<u>PM_LED-10</u>	Плата на 10 светодиодов
<u>PM_LED-18</u>	Плата на 18 светодиодов
Платы конвертирования цифровых и электрических сигналов	
<u>PM_CNV-DI16_sink</u>	Подключение 16 дискретных входов постоянного напряжения
<u>PM_CNV-DQ16_src</u>	Подключение 16 дискретных выходов постоянного напряжения
<u>PM_CNV-RQ8</u>	Подключение 8 релейных выходов
<u>PM_CNV-AI4_RTD</u>	Подключение 4 термосопротивлений
<u>PM_CNV-AI4_TC</u>	Подключение 4 термопар
<u>PM_CNV-AI4_W</u>	Подключение 4 тензодатчиков
<u>PM_CNV-AI8_IU</u>	Подключение 8 датчиков 4 .. 20 мА или 0 .. 10 В
<u>PM_CNV-AQ</u>	Подключение аналоговых выходов
Платы для создания интерфейса оператора	
<u>PM_HMI-Keyboard</u>	Клавиатура 7x7
<u>PM_HMI-Touch</u>	Подключение touch-контроллера дисплея
Платы для отладки	
<u>PM_DBG-FFC</u>	Для подключения осциллографа в разрыв кабеля FFC

Таблица 2. Перечень плат

8.1. PM_CPU-RP - контроллер на базе Raspberry Pi

ЦПУ на базе мини-компьютера Raspberry Pi, или совместимого по габаритам, креплению и 40-пиновому штекеру.

Программировать можно практически на всех языках программирования, поддерживающих архитектуру процессора ARM64.

8.1.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

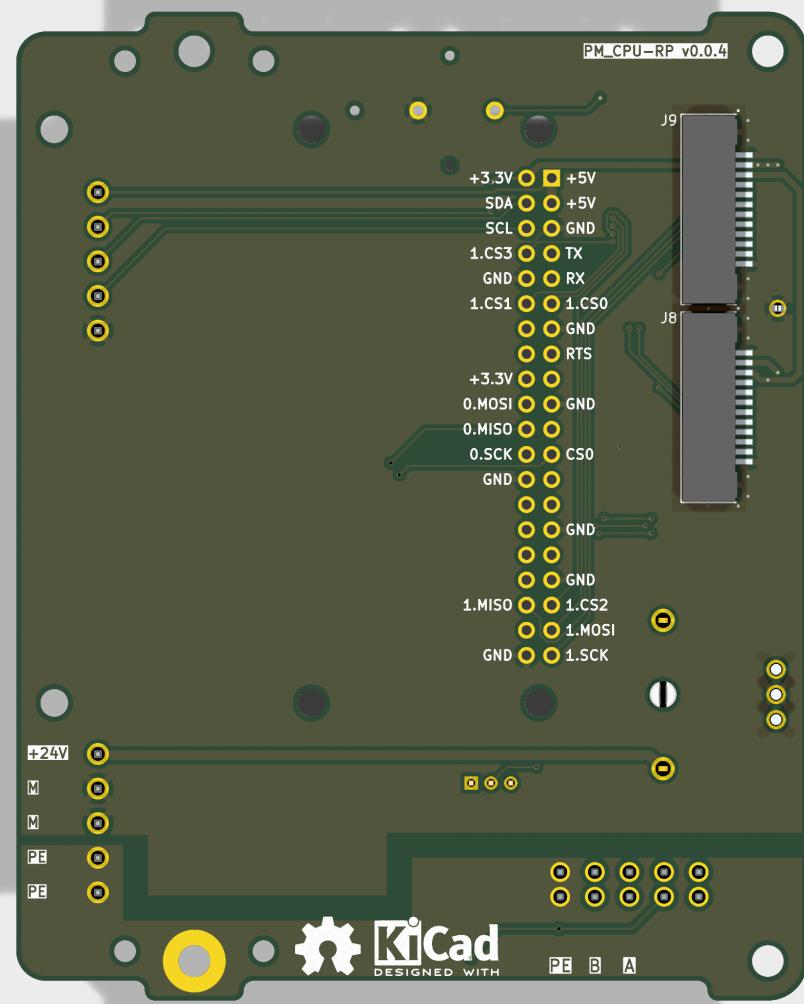
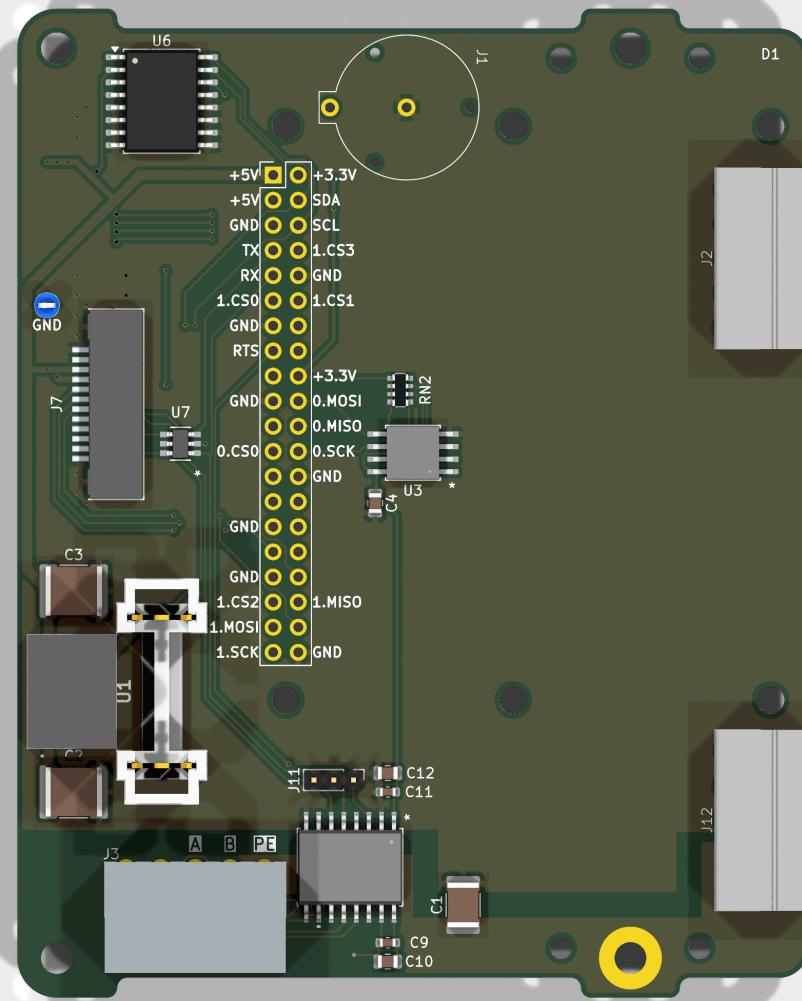


Таблица 3. Внешний вид платы PM_CPU-RP

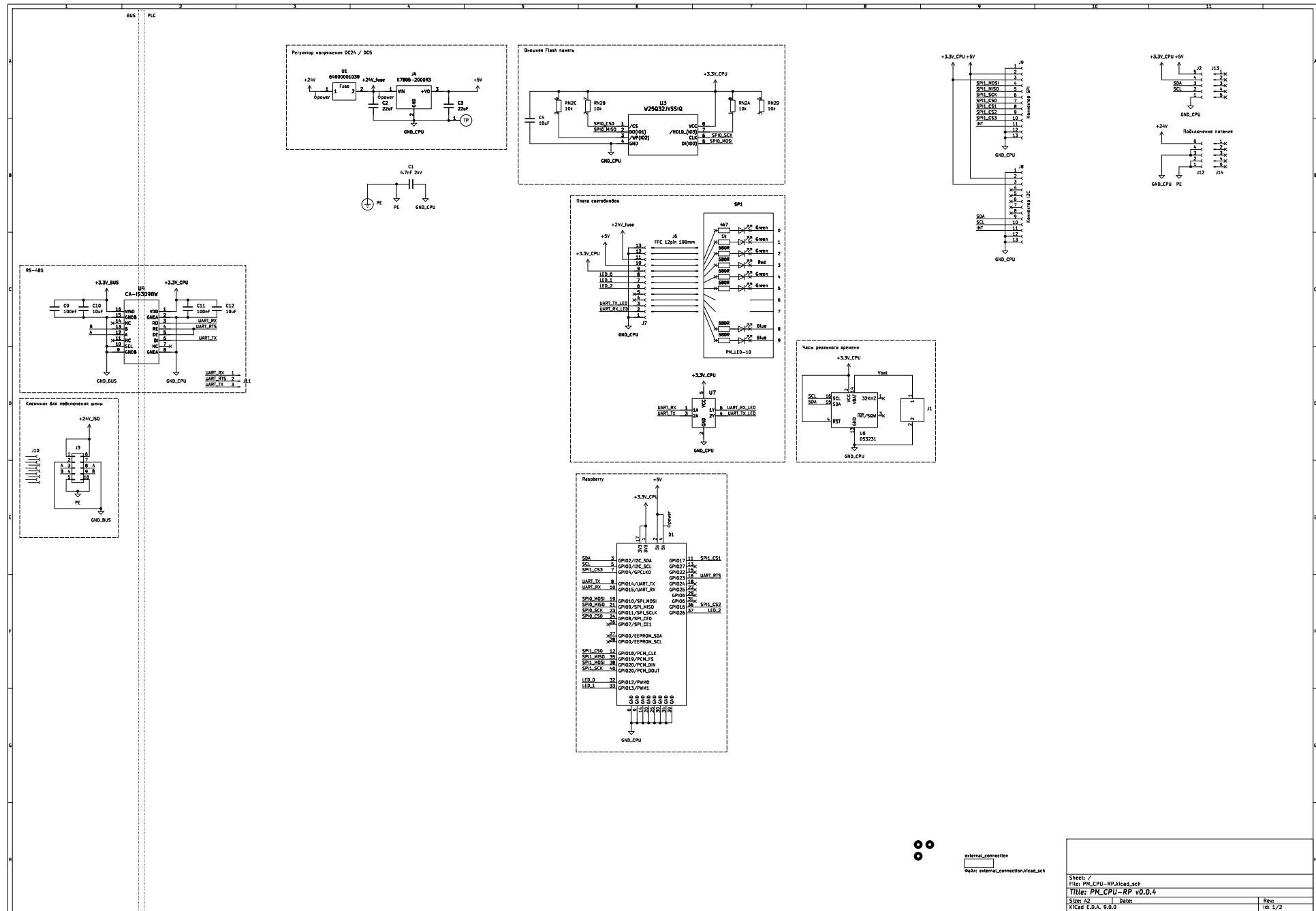


Рис. 11. Принципиальная электрическая схема платы PM_CPU-RP

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1	1	C_4.7nF_2kV_1812
C2, C3	2	C_22uF_50V_2220
C4, C10, C12	3	C_10uF_16V_0805_MLCC-X5R
C9, C11	2	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
D2, D3, D4, D6, D7	5	XL-1606SYGC
D5	1	XL-1606SURC
D8, D9	2	XL-1606UBC
J1	1	BS-12-A1AJ002-F
J2, J12	2	15EDGRC-3.5-05P
J3	1	15EDGRHC-THR-3.5-10P
J4	1	K7805-2000R3
J6	1	FFC_12P_P1.0_100mm_straight
J7, J8, J9	3	AFA07-S12FCC-00
J10	1	15EDGKNH-3.5-10P
J11	1	PinHeader_01x03_P2.00_THT_straight
J13, J14	2	15EDGK-3.5-05P
R1	1	R_1k_0603_1%
R2	1	R_4k7_0603_1%
R3, R4, R5, R6, R7, R8	6	R_680R_0603_1%
RN2	1	R_10k_0603x4_1%
SP1	1	PM_LED-10-v0.0.1
U1	1	64900001039
U2	1	Keystone_5117
U3	1	W25Q32JVSSIQ
U4	1	CA-IS3098W
U6	1	DS3231SN
U7	1	SN74LVC2G14DBVR

Таблица 4. Перечень элементов платы PM_CPU-RP

8.2. PM_CPU-ESP32_C3

8.3. PM MCU-ESP32_C3

Плата с микроконтроллером ESP32-C3 и регулятором напряжения.

Функциональная схема платы представлена на рисунке 12.

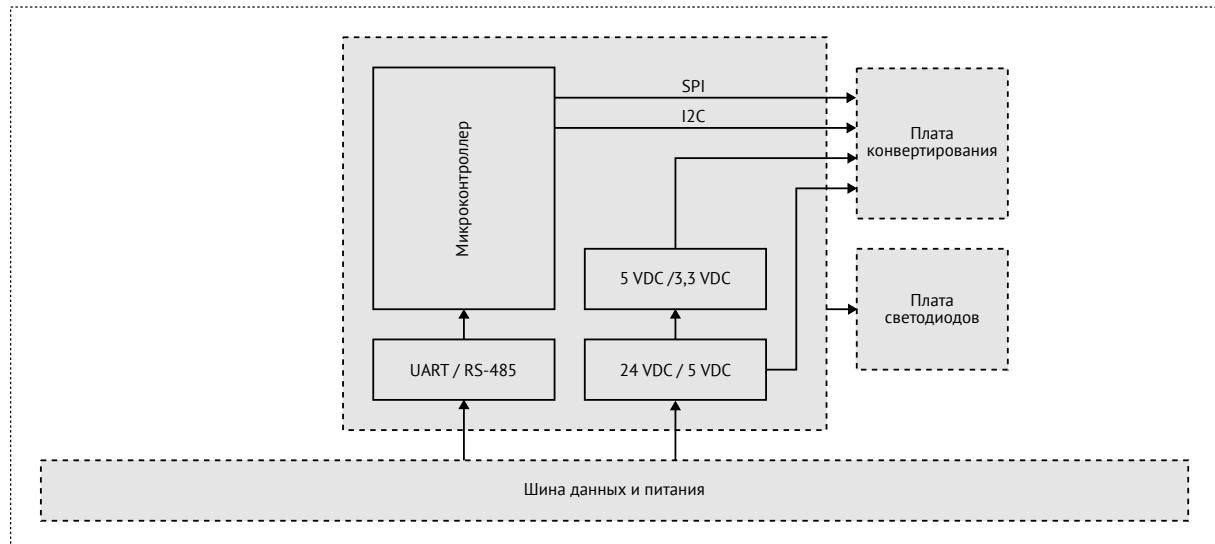


Рис. 12. Функциональная схема платы

8.3.1. Питание

По межмодульной шине поступает питание 24 В постоянного напряжения. Поэтому на плате устанавливается изолирующий DC / DC преобразователь 24 В / 5 В. В одно посадочное место можно установить один из трех преобразователей:

- B2405LS-1WR3 - мощность 1 Вт
- B2405S-2WR3 - мощность 2 Вт
- B2405S-3WR3 - мощность 3 Вт

Мощность преобразователя выбирается на основе количества и потребления плат конвертирования.

Для получения напряжения 3,3 В на плате установлен LDO регулятор с максимальным током 1 А.

8.3.2. Микроконтроллер

Используется модуль на базе микроконтроллера ESP32-C3 [7]. В посадочное место можно установить 2 вида модулей:

- ESP32-C3-WROOM-02 - со встроенной антенной.
- ESP32-C3-WROOM-02U - без встроенной антенны. Есть выход IPEX для подключения внешней антенны.

В остальном модули ESP идентичны. Предпочтительным является использование модуля без антенны. Все соединения между модулями выполняются по проводной связи. Если всё-таки беспроводное подключение необходимо, то нужно использовать внешнюю антенну. Платы могут располагаться в металлическом корпусе, который будет экранировать беспроводную связь.

Плата микроконтроллера подключается к плате конвертирования через 2 12-пиновых разъема FFC. На разъемы выведены протоколы SPI (раздел 6.1) и I²C (раздел 6.2).

Также на оба коннектора выводится питание +5 В и +3,3 В.

Подключение к основной плате модуля и плате светодиодов выполняется через 12-пиновые кабели FFC.

8.3.3. Загрузка прошивки

Микроконтроллер программируется с помощью обычного кабеля Micro-USB. Поскольку выходы микроконтроллера GPIO18 и GPIO19, используемые для USB-подключения, можно переиспользовать, микроконтроллер может автоматически не перейти в режим загрузки новой прошивки. Поэтому на плату добавлены кнопки BOOT и EN, для перевода микроконтроллера в режим загрузки. Алгоритм для загрузки следующий:

- зажать кнопку BOOT
- не отпуская BOOT, нажать кнопку EN
- через 1 с отпустить EN, не отпуская BOOT
- отпустить кнопку BOOT

После этого микроконтроллер переходит в режим загрузки.

8.3.4. Подключение к шине RS-485

Микроконтроллер подключается к шине RS-485 через приемопередатчик UART - RS-485 с гальванической изоляцией. Подробнее о преобразователе описано в разделе 7.4.

Поскольку у каждого модуля на шине данных должен быть уникальный адрес, на плате есть трехпозиционный DIP-переключатель для задания адреса конкретного модуля. Таким образом, можно использовать до $2^3 = 8$ модулей одного типа.

Подключение к шине данных и питания выполняется через 10-пиновый коннектор (2 ряда по 5 пинов).

8.3.5. Внешний вид платы, схема и спецификация

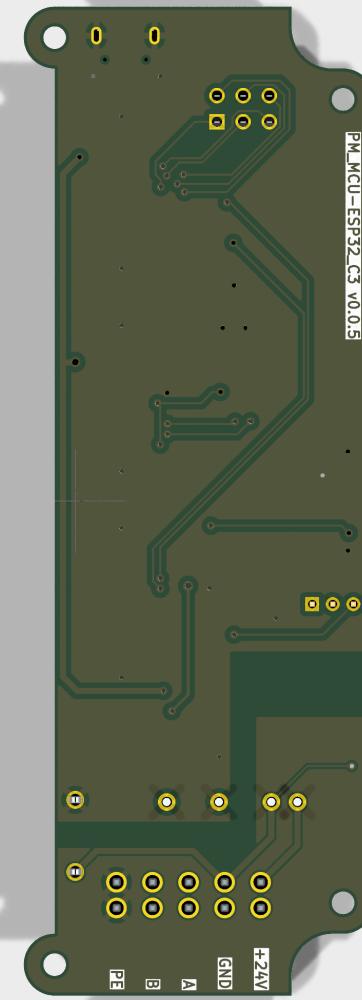
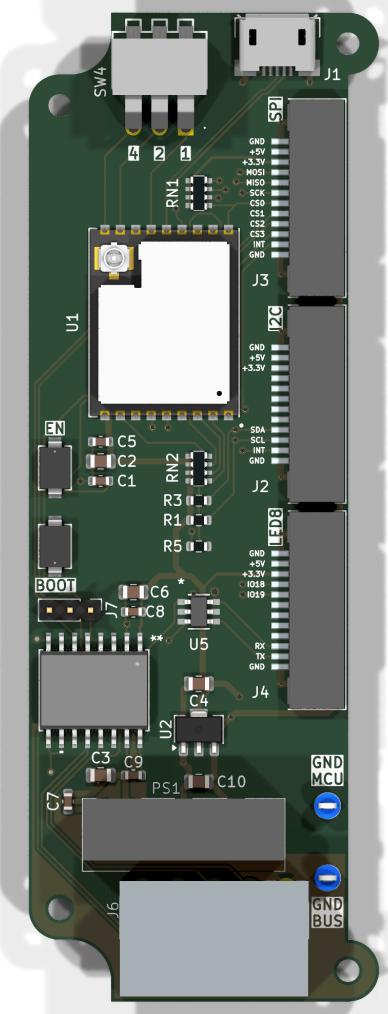


Таблица 5. Внешний вид платы PM_MCU-ESP32_C3

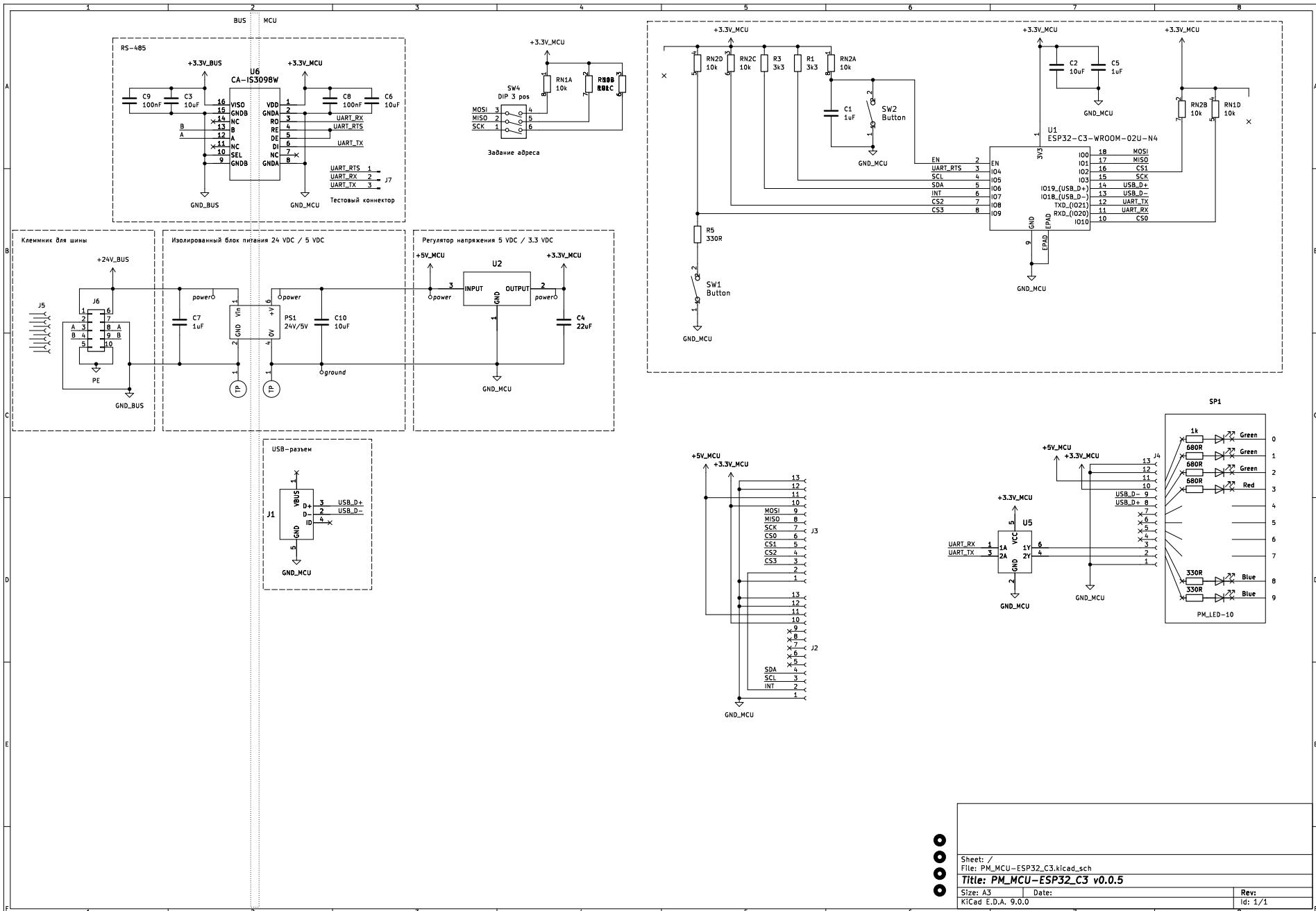


Рис. 13. Принципиальная электрическая схема платы PM MCU-ESP32_C3

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1, C5	2	C_1uF_16V_0603_MLCC-X7R
C2, C3, C6, C10	4	C_10uF_16V_0805_MLCC-X5R
C4	1	C_22uF_16V_0805_MLCC-X5R
C7	1	C_1uF_50V_0603_MLCC-X7R
C8, C9	2	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
D1, D3, D5	3	XL-1606SYGC
D2, D4	2	XL-1606UBC
D6	1	XL-1606SURC
J1	1	U254-051T-4BH83-S1S
J2, J3, J4	3	AFA07-S12FCC-00
J5	1	15EDGKNH-3.5-10P
J6	1	15EDGRHC-THR-3.5-10P
J7	1	PinHeader_01x03_P2.00_THT_straight
PS1	1	B2405LS-1WR3
R1, R3	2	R_3k3_0603_1%
R2	1	R_1k_0603_1%
R4, R8, R9	3	R_680R_0603_1%
R5, R6, R7	3	R_330R_0603_1%
RN1, RN2	2	R_10k_0603x4_1%
SP1	1	PM_LED-10-v0.0.1
SW1, SW2	2	TS-1088-AR02016
SW4	1	DA-03BLP
U1	1	ESP32-C3-WROOM-02U-N4
U2	1	CJA1117B-3.3
U3, U4	2	Keystone_5117
U5	1	SN74LVC2G14DBVR
U6	1	CA-IS3098W

Таблица 6. Перечень элементов платы PM MCU-ESP32_C3

8.4. PM_LED-10 - плата с 10 светодиодами

Плата с 8 светодиодами. Используются токоограничивающие резисторы номиналом 680 Ом, что при управлении светодиодами от напряжения 3,3В дает ток около 5mA.

Сигналы управления светодиодами подключаются через 10-пиновый шлейф FFC. На плате 4 параллельных разъема J1..J4, подключаться можно через любой.

8.4.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

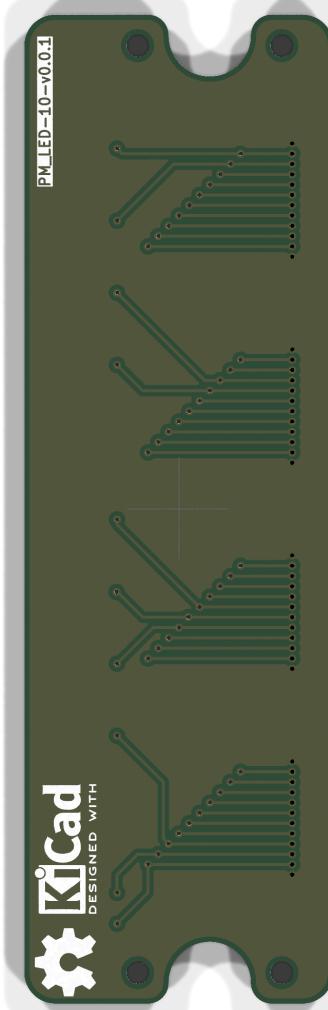
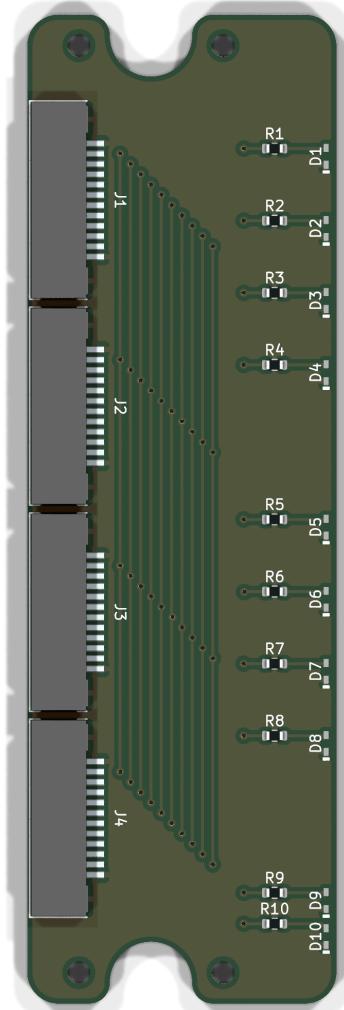


Таблица 7. Внешний вид платы PM_LED-10

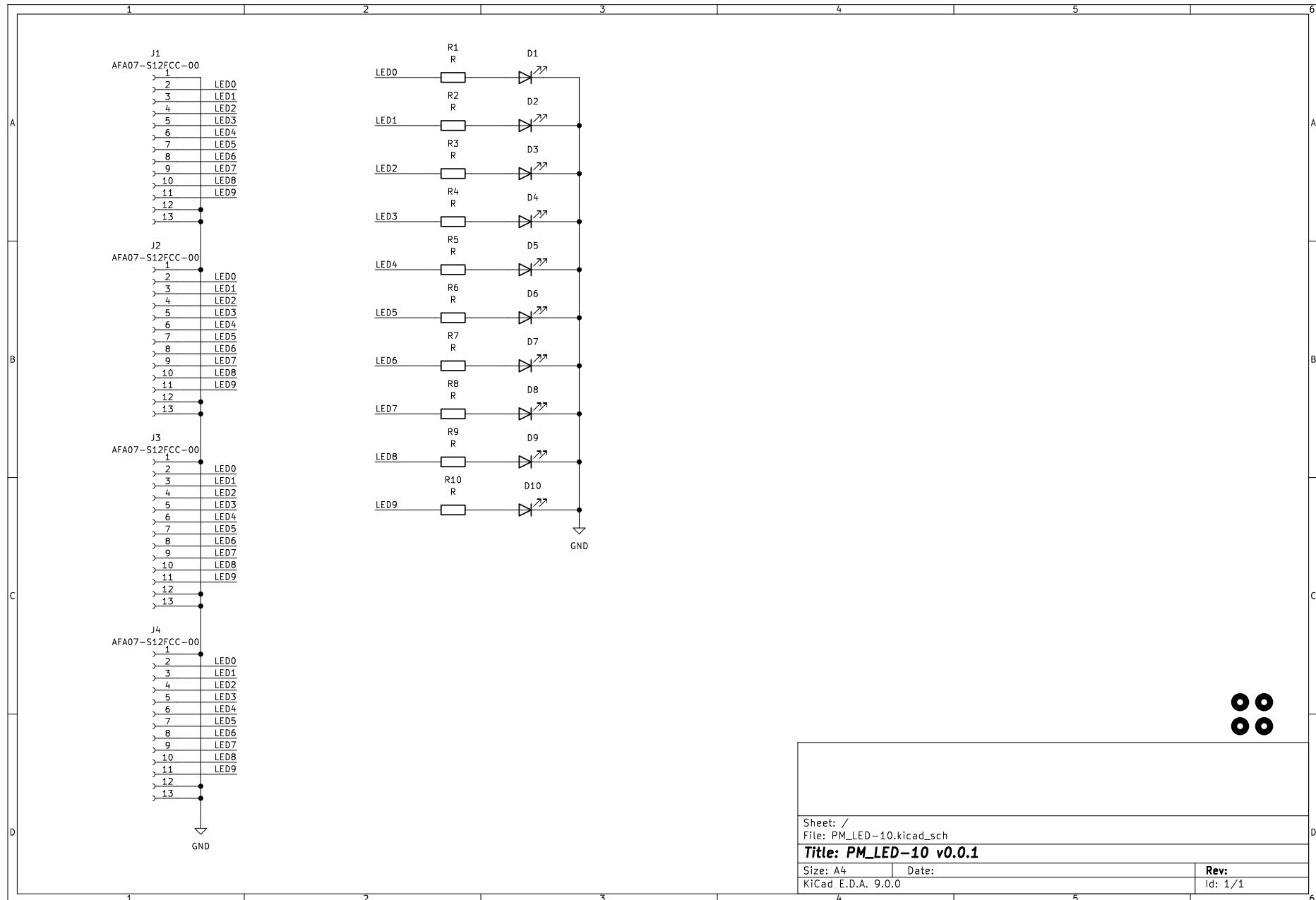


Рис. 14. Принципиальная электрическая схема платы PM_LED-10

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
J1	1	AFA07-S12FCC-00

Таблица 8. Перечень элементов платы PM_LED-10

8.5. PM_LED-18 - плата с 18 светодиодами

Плата с 16 светодиодами. Используются токоограничивающие резисторы номиналом 680 Ом, что при управлении светодиодами от напряжения 3,3В дает ток около 5mA.

Сигналы управления светодиодами подключаются через два 10-пиновых шлейфа FFC. Каждый шлейф можно подключить в один из двух разъемов:

- верхние 8 светодиодов - через разъем J1 или J2
- нижние 8 светодиодов - через разъем J3 или J4

8.5.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

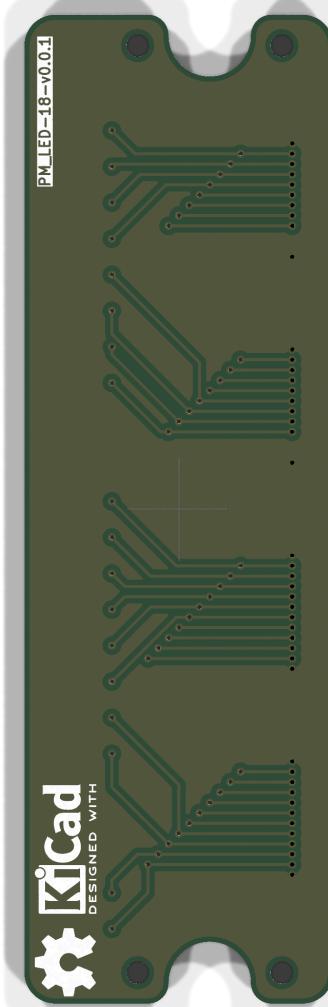
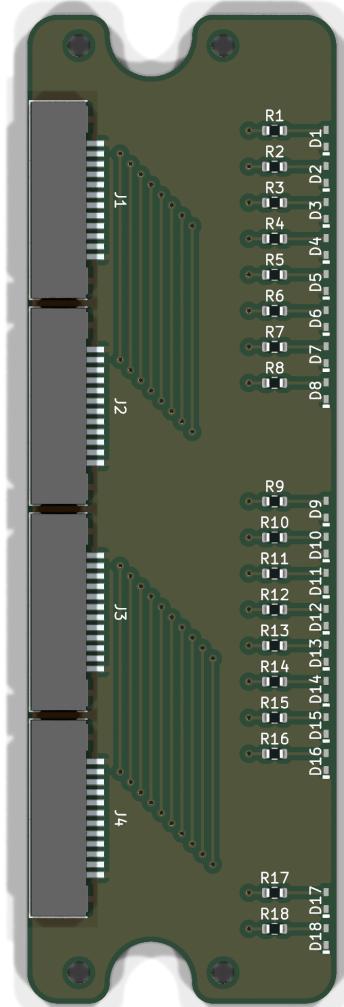


Таблица 9. Внешний вид платы PM_LED-18

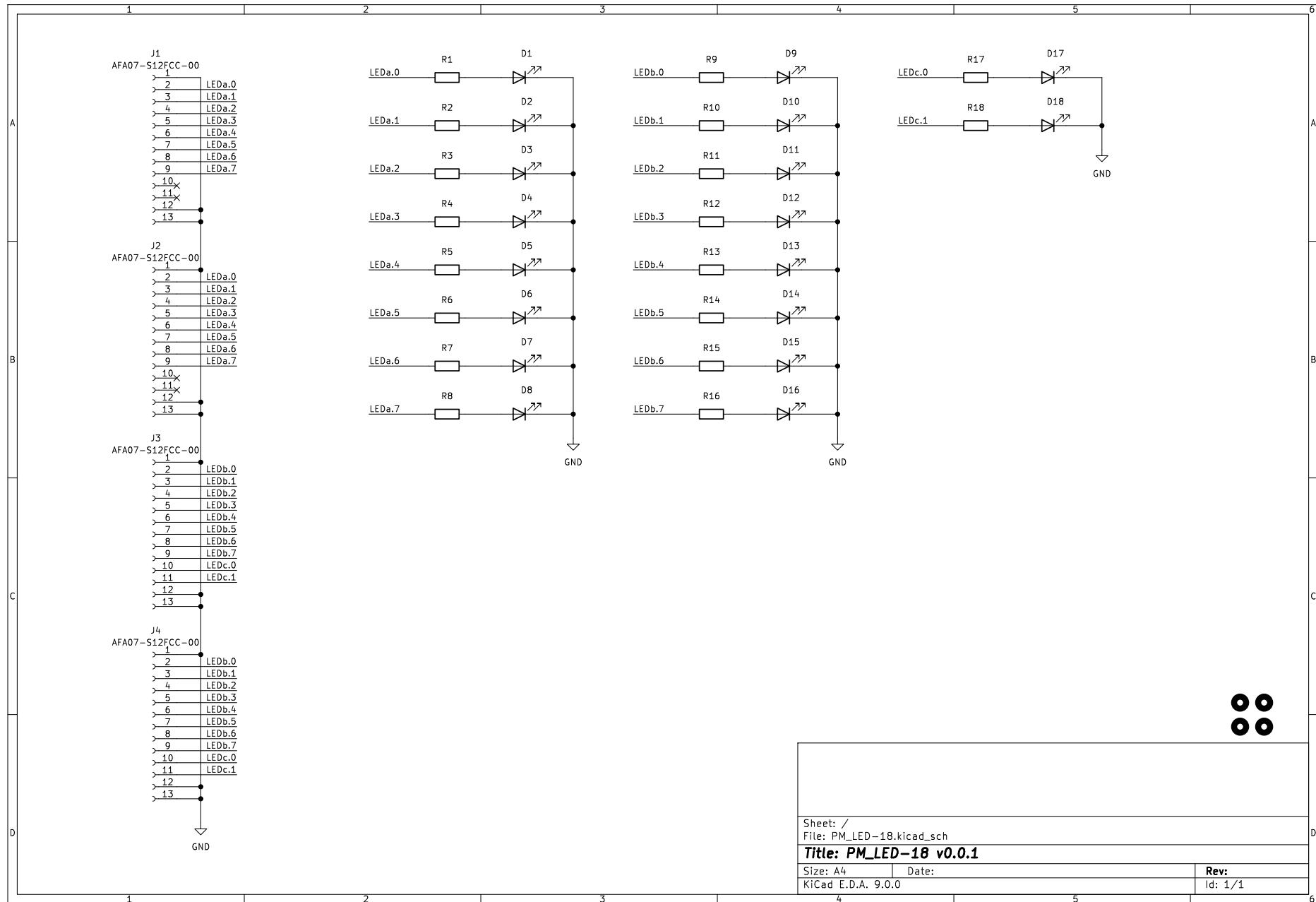


Рис. 15. Принципиальная электрическая схема платы PM_LED-18

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
J1, J3	2	AFA07-S12FCC-00

Таблица 10. Перечень элементов платы PM_LED-18

8.6. PM_CNV-DI16_sink

Плата для подключения 16 дискретных входов. В схеме приведены компоненты для 24 В постоянного входного напряжения, но при изменении номиналов резисторов можно подключать датчики в диапазоне 5 .. 60 В.

Функциональная схема платы представлена на рисунке 16.

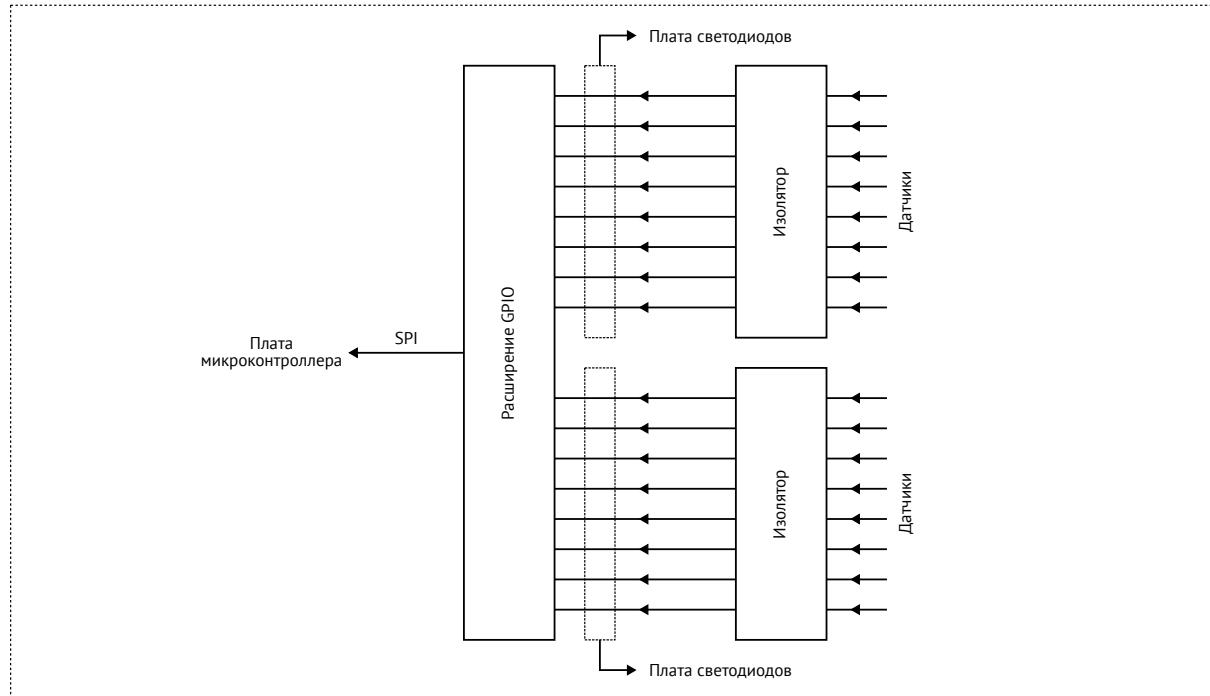


Рис. 16. Функциональная схема платы

Преобразование высокого входного напряжения в уровень напряжения микроконтроллера +3,3 В осуществляется с помощью чипа CA-IS3980S. Кроме понижения входного напряжения, чип также обеспечивает гальваническую изоляцию, подробнее в разделе 4.1.3. Основные характеристики:

- Совместимость со стандартом IEC 61131-2, тип входов 1, 2 и 3.
- 8 параллельных каналов.
- Скорость передачи до 2 Mbps.
- $\pm 300 \frac{kV}{\mu s}$ CMTI.
- $2500V_{RMS}$ изоляция.

Все характеристики приведены в [6].

Схема подключения отдельного канала показана на рисунке 17.

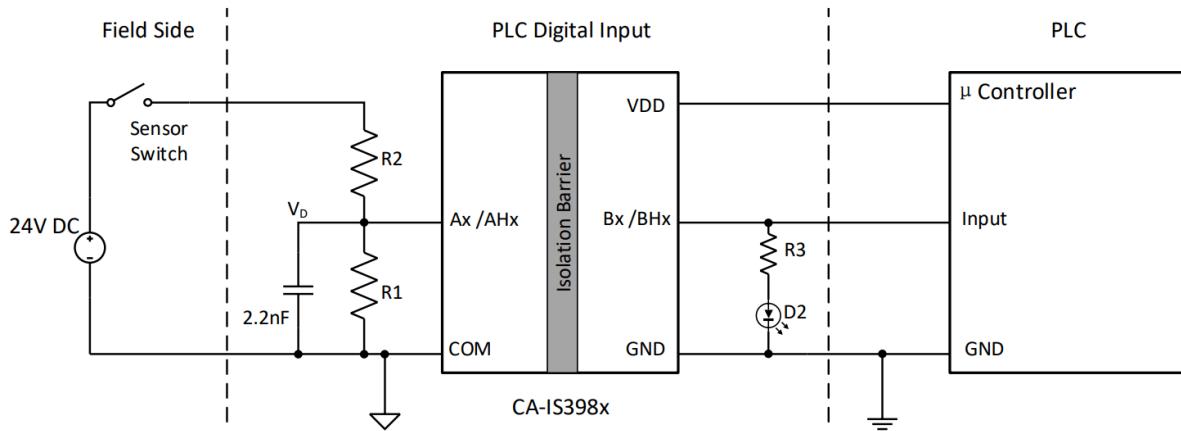


Рис. 17. Схема подключения отдельного канала

Номиналы выбираются исходя из напряжения и обеспечения требуемой характеристики. Рекомендуемые значения сопротивлений для напряжения 24 В приведены в таблице 11. Для подключения датчиков на другие уровни напряжения значения резисторов нужно корректировать.

Тип согласно IEC 61131-2	R_1	R_2
Тип 1	2,4 кОм	6,2 кОм
Тип 2	390 Ом	1,5 кОм
Тип 3	750 Ом	2,7 кОм

Таблица 11. Рекомендуемые значения сопротивлений для входного напряжения 24 В

После преобразования в напряжение 3,3 В цифровые сигналы поступают на вход расширителя входов MCP23S17. Расширитель входов сохраняет состояние входов в двух 8-битных регистрах. Микроконтроллер периодически опрашивает состояние регистров по шине SPI. Плата микроконтроллера подключается через разъем FFC.

С обратной стороны платы есть 4 перемычки - CS0, CS1, CS2, CS3. При сборке модуля необходимо замкнуть одну из 4. Также с обратной стороны платы есть коннектор FFC, который позволяет передавать шину данных на следующие платы. На каждой плате должны быть замкнуты разные перемычки CS. Таким образом, можно собрать модуль на 64 дискретных входа.

На плате есть два разъема FFC, через которые подключается плата светодиодов PM_LED-18.

8.6.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

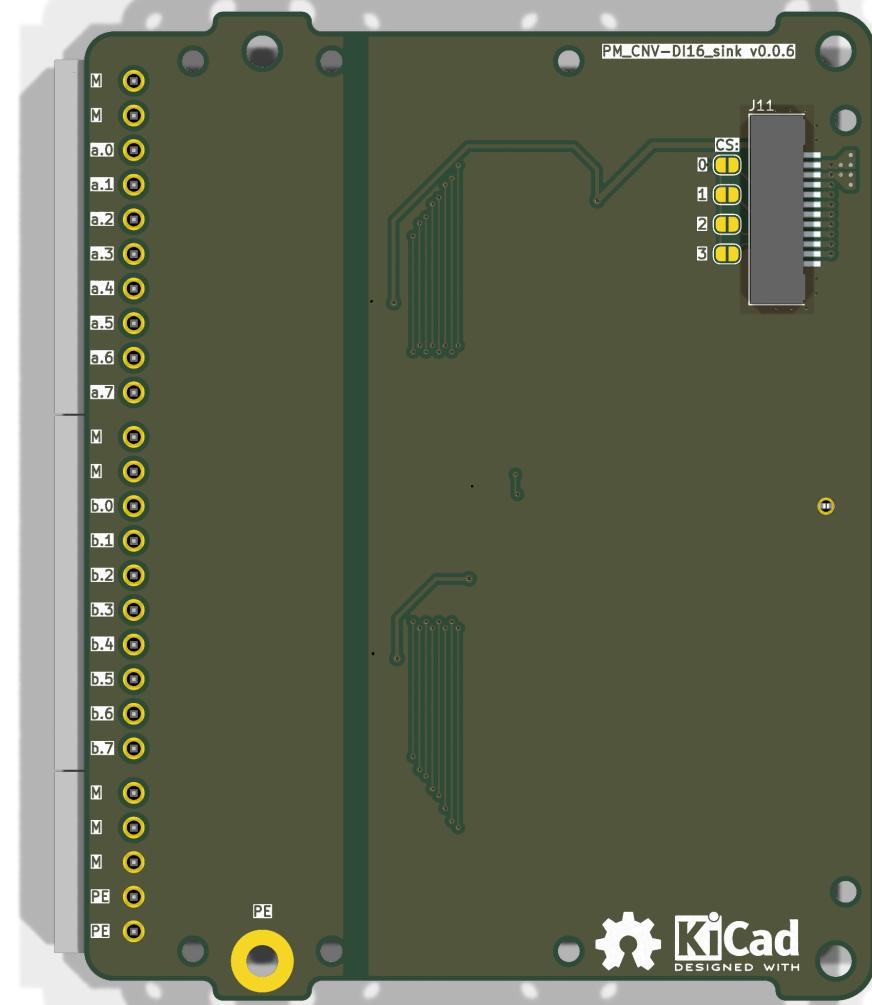
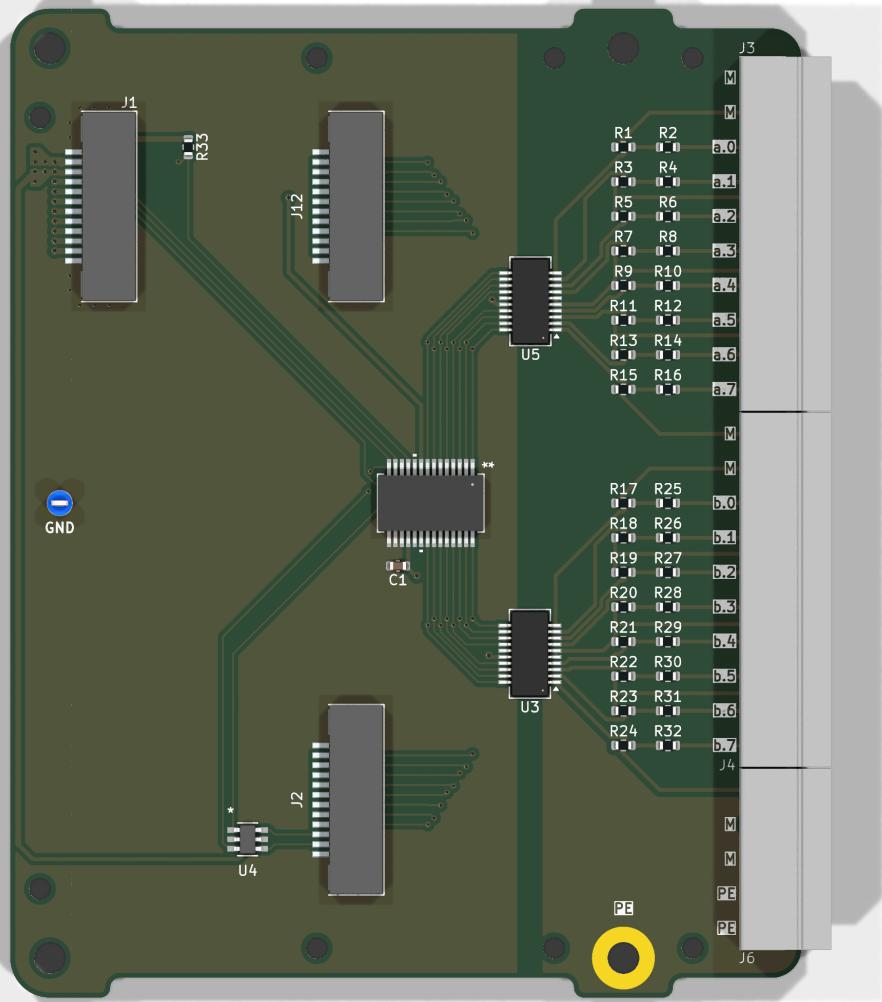


Таблица 12. Внешний вид платы PM_CNV-DI16_sink

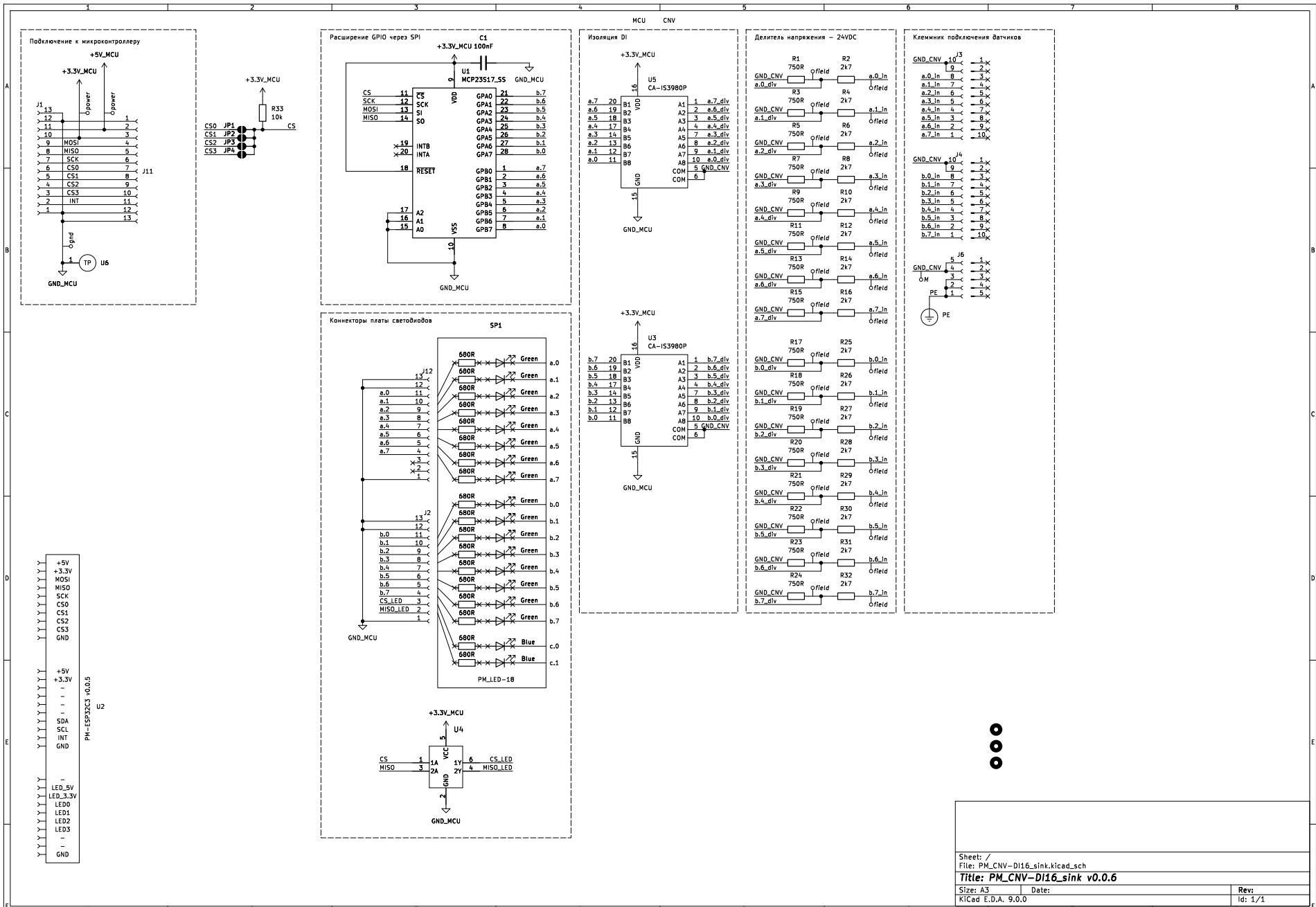


Рис. 18. Принципиальная электрическая схема платы PM_CNV-DI16_sink

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1	1	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16	16	XL-1606SYGC
D17, D18	2	XL-1606UBC
J1, J2, J11, J12	4	AFA07-S12FCC-00
J3, J4	2	15EDGRC-3.5-10P
J6	1	15EDGRC-3.5-05P
J8, J9	2	15EDGK-3.5-10P
J10	1	15EDGK-3.5-05P
R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24	16	R_750R_0603_1%
R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32	16	R_2k7_0603_1%
R33	1	R_10k_0603_1%
R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51	18	R_680R_0603_1%
SP1	1	PM_LED-18-v0.0.1
U1	1	MCP23S17-E/SS
U3, U5	2	CA-IS3980P
U4	1	SN74LVC2G14DBVR
U6	1	Keystone_5117

Таблица 13. Перечень элементов платы PM_CNV-DI16_sink

8.7. PM_CNV-DQ16_src

Модуль для управления 16 дискретными выходами. Выходы постоянного напряжения до 50 В.

8.7.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

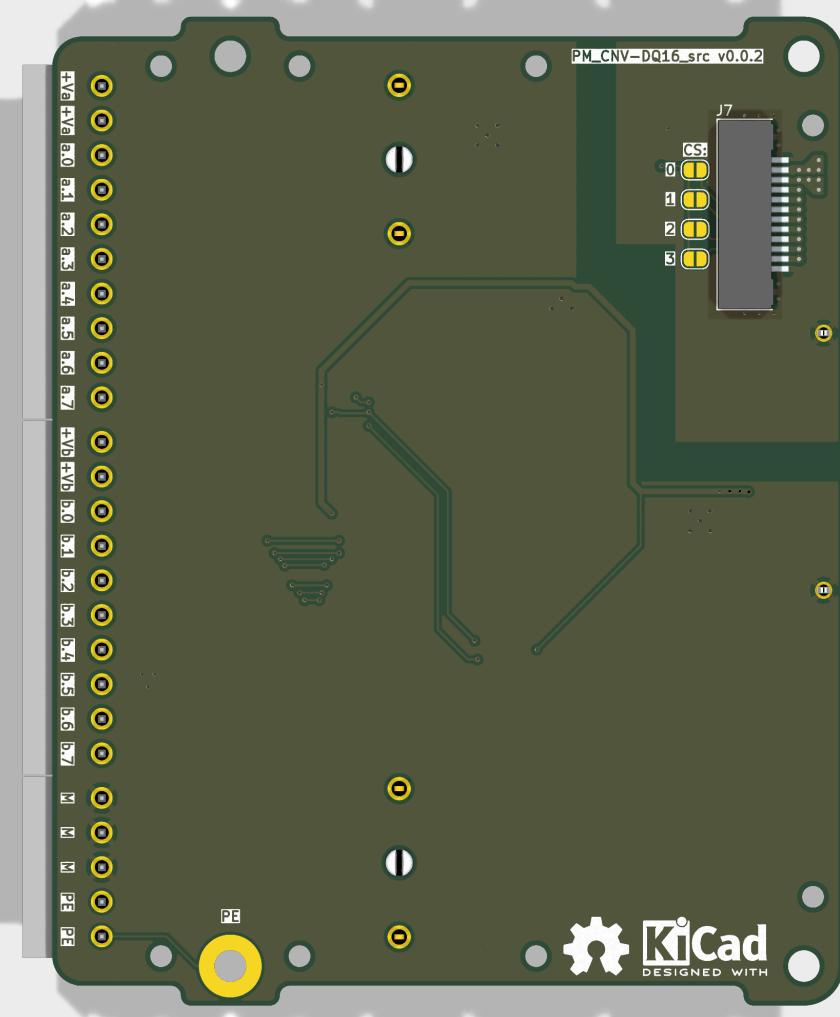
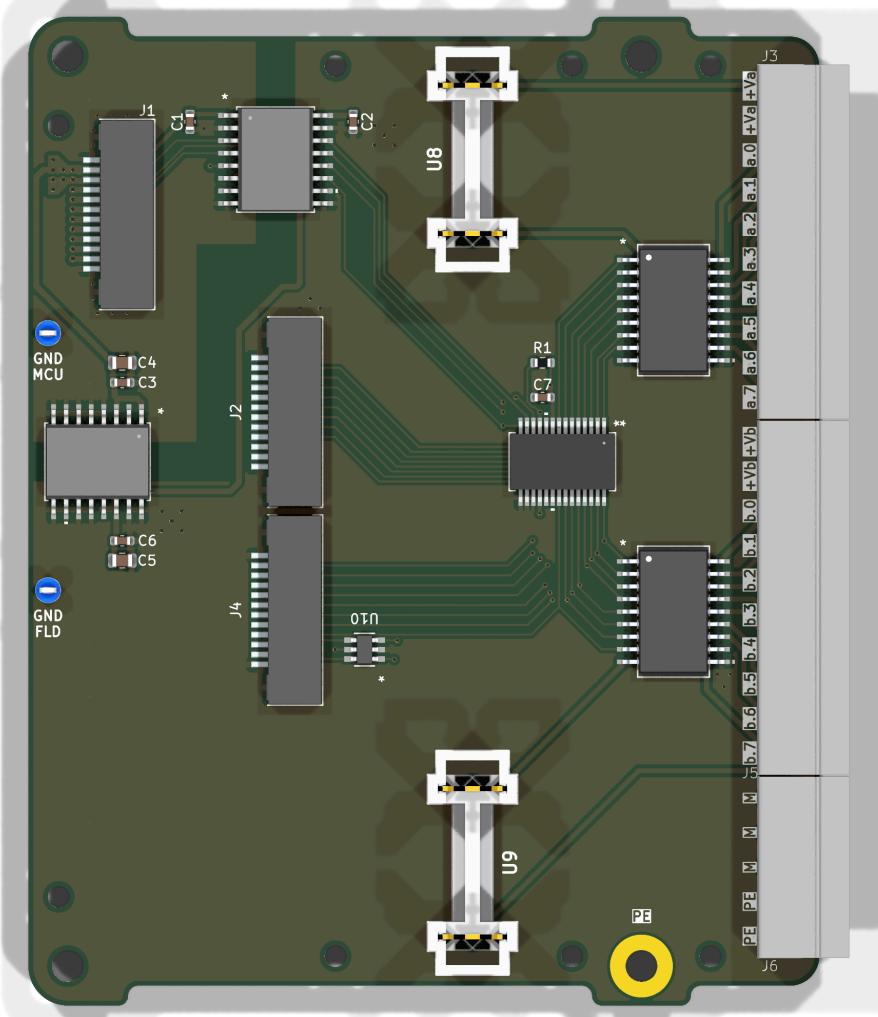


Таблица 14. Внешний вид платы PM_CNV-DQ16_src

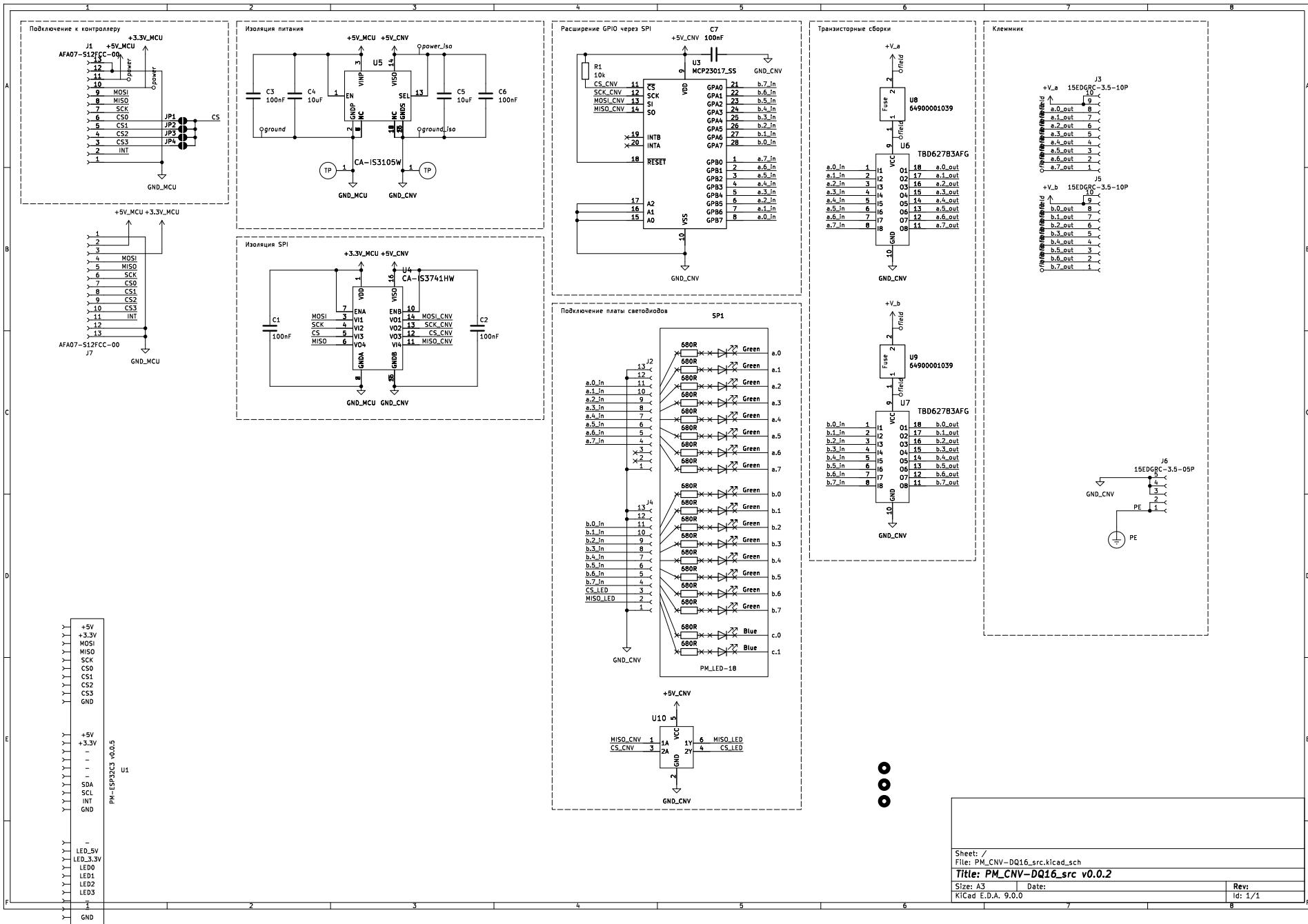


Рис. 19. Принципиальная электрическая схема платы PM_CNV-DQ16_src

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1, C2, C3, C6, C7	5	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
C4, C5	2	C_10uF_16V_0805_MLCC-X5R
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16	16	XL-1606SYGC
D17, D18	2	XL-1606UBC
J1, J2, J4, J7	4	AFA07-S12FCC-00
J3, J5	2	15EDGRC-3.5-10P
J6	1	15EDGRC-3.5-05P
R1	1	R_10k_0603_1%
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19	18	R_680R_0603_1%
SP1	1	PM_LED-18-v0.0.1
U2, U11	2	Keystone_5117
U3	1	MCP23S17-E/SS
U4	1	CA-IS3741HW
U5	1	CA-IS3105W
U6, U7	2	TBD62783AFG
U8, U9	2	64900001039
U10	1	SN74LVC2G14DBVR

Таблица 15. Перечень элементов платы PM_CNV-DQ16_src

8.8. PM_CNV-RQ8 - плата управления 8 реле

Модуль для подключения 8 релейных выходов. Допустимая подключаемая нагрузка на канал 2А. Контакты реле подключаются независимо, что позволяет подключать нагрузку от разных источников.

8.8.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

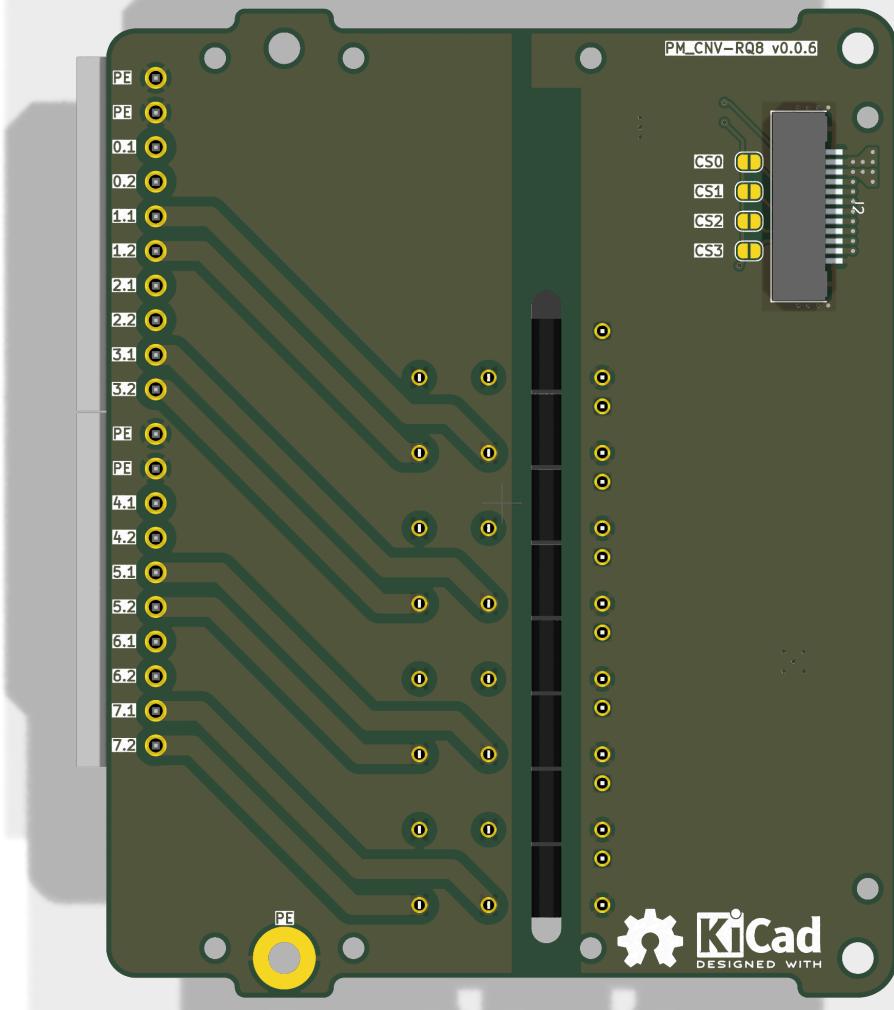
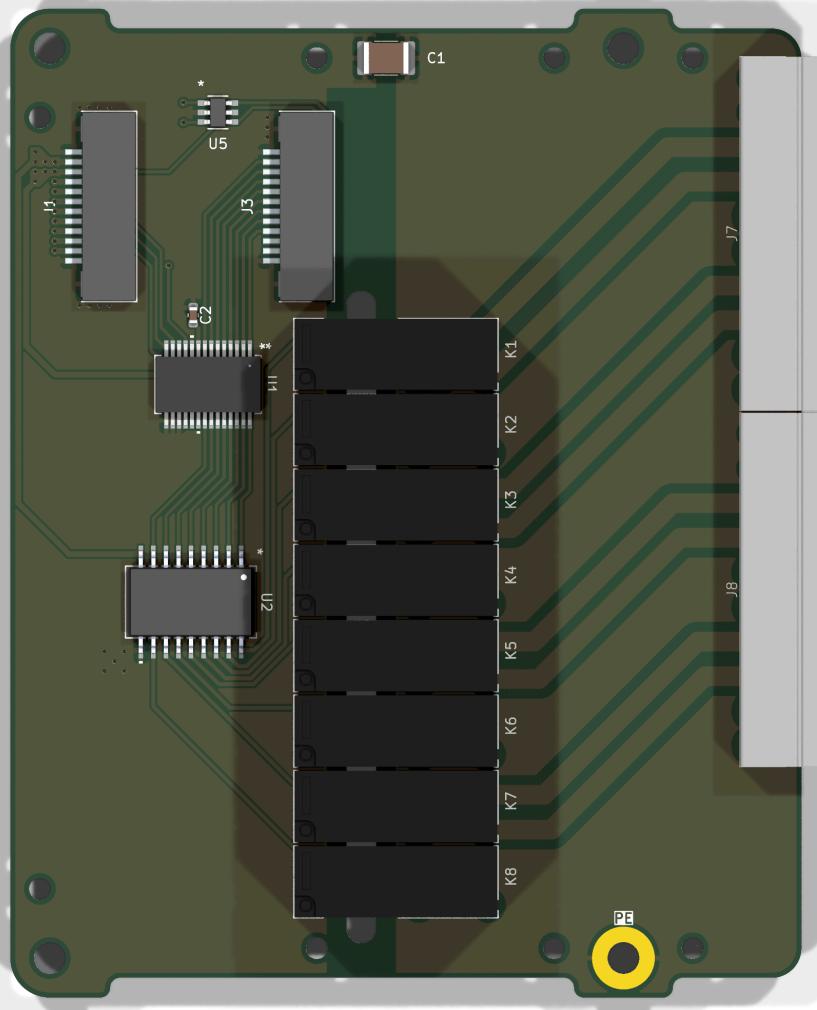


Таблица 16. Внешний вид платы PM_CNV-RQ8

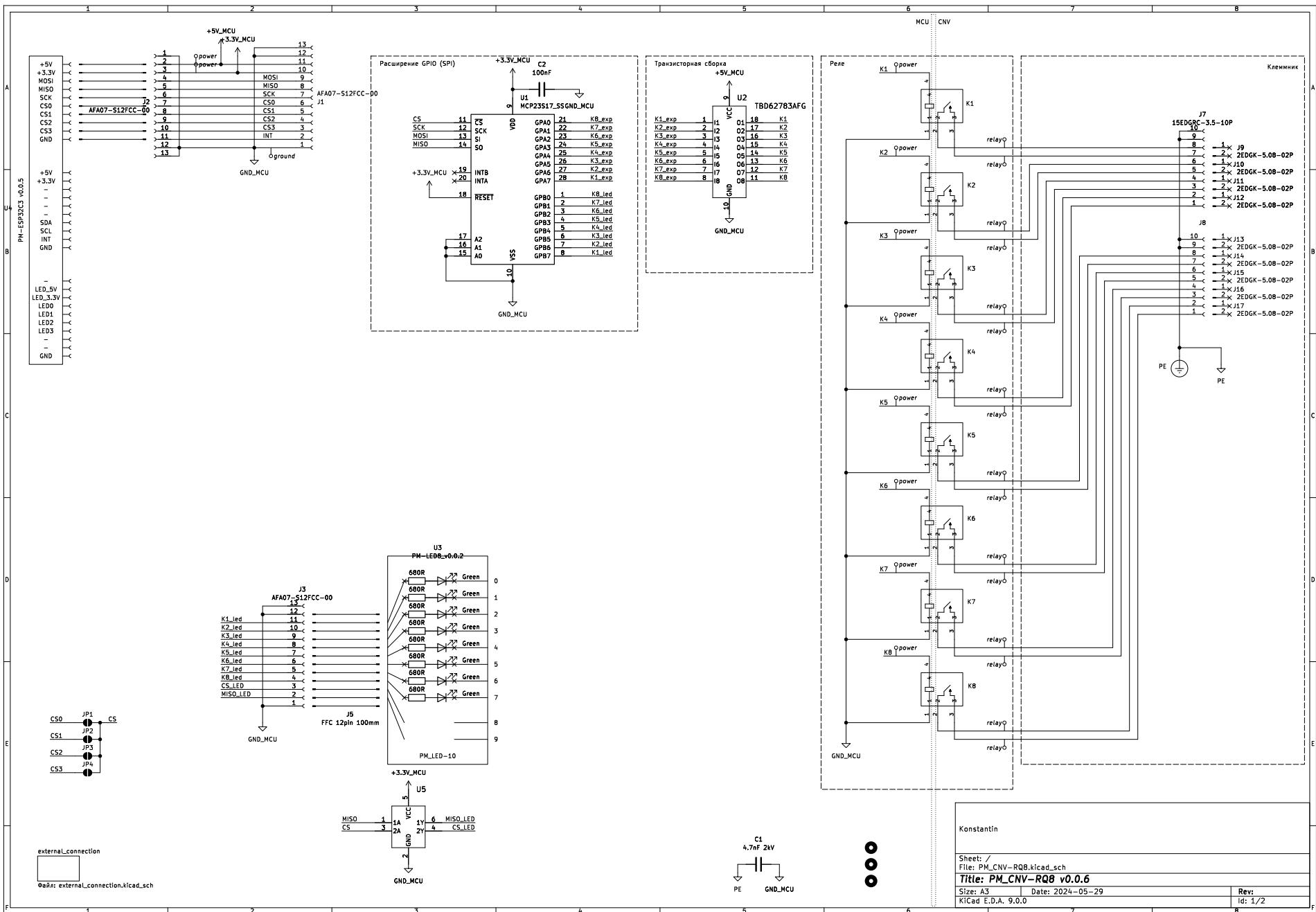


Рис. 20. Принципиальная электрическая схема платы PM_CNV-RQ8

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1	1	C_4.7nF_2kV_1812
C2	1	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	8	XL-1606SYGC
J1, J2, J3	3	AFA07-S12FCC-00
J4	1	FFC_10P_P1.0_50mm_reverse
J5	1	FFC_12P_P1.0_100mm_straight
J7, J8	2	15EDGRC-3.5-10P
J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17	9	2EDGK-5.08-02P
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8	8	G5NB-1A-E-DC5
R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41	8	R_680R_0603_1%
U1	1	MCP23S17-E/SO
U2	1	TBD62783AFG
U3	1	PM_LED-10-v0.0.1
U5	1	SN74LVC2G14DBVR

Таблица 17. Перечень элементов платы PM_CNV-RQ8

**8.9. PM_CNV-AI4_RTD - плата аналогового ввода 4 термосопротивле-
ний**

8.10. PM_CNV-AI4_TC - плата аналогового ввода 4 термопар

8.11. PM_CNV-AI4_W - плата аналогового ввода 4 тензодатчиков

Плата аналогового ввода для опроса сигналов тензодатчиков. Можно подключить до 4 тензодатчиков.

Гальваническая изоляция от микроконтроллера реализована с помощью 2 микросхем:

- CA-IS3105W - DC / DC преобразователь для цепей питания.
- CA-IS3741HW - преобразователь сигналов.

Схемотехника платы разработана на основе примера отладочной платы от производителя - [8].

8.11.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

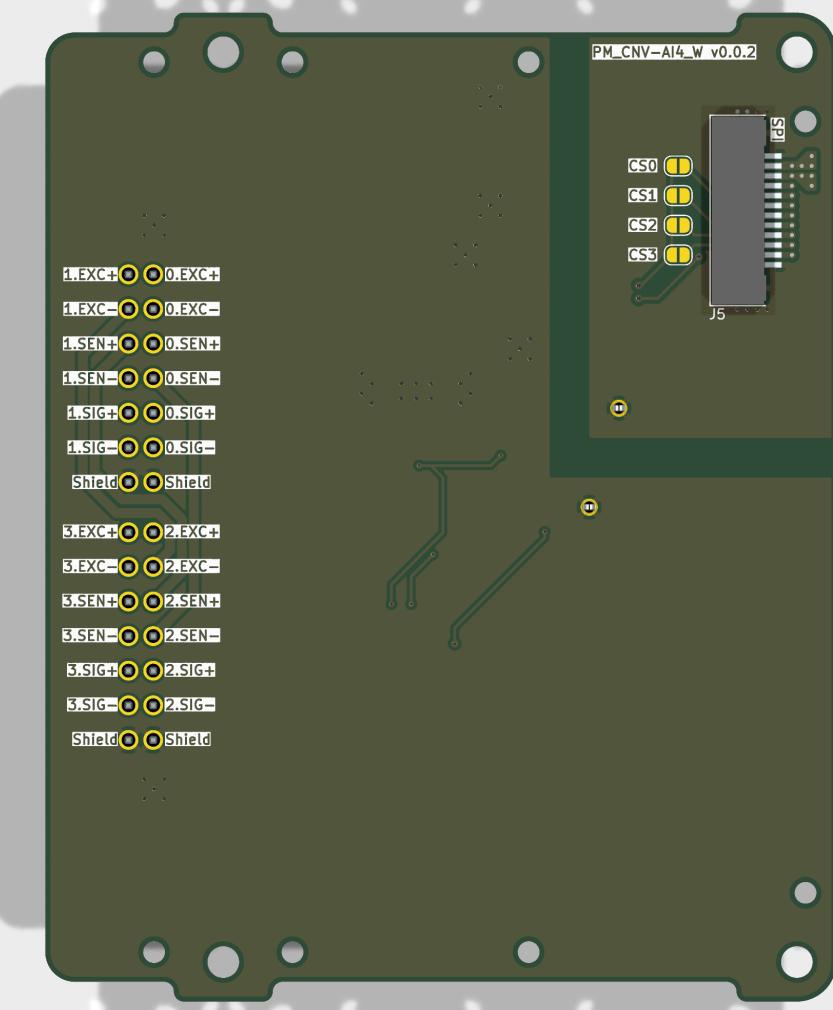
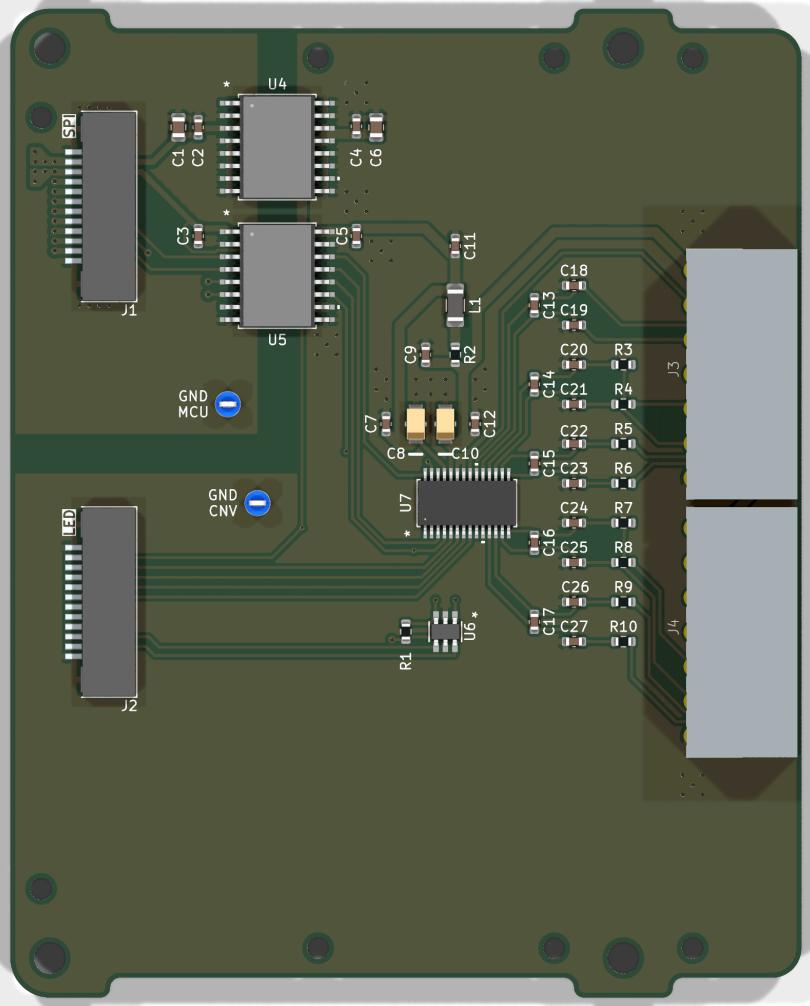


Таблица 18. Внешний вид платы PM_CNV-AI4_W

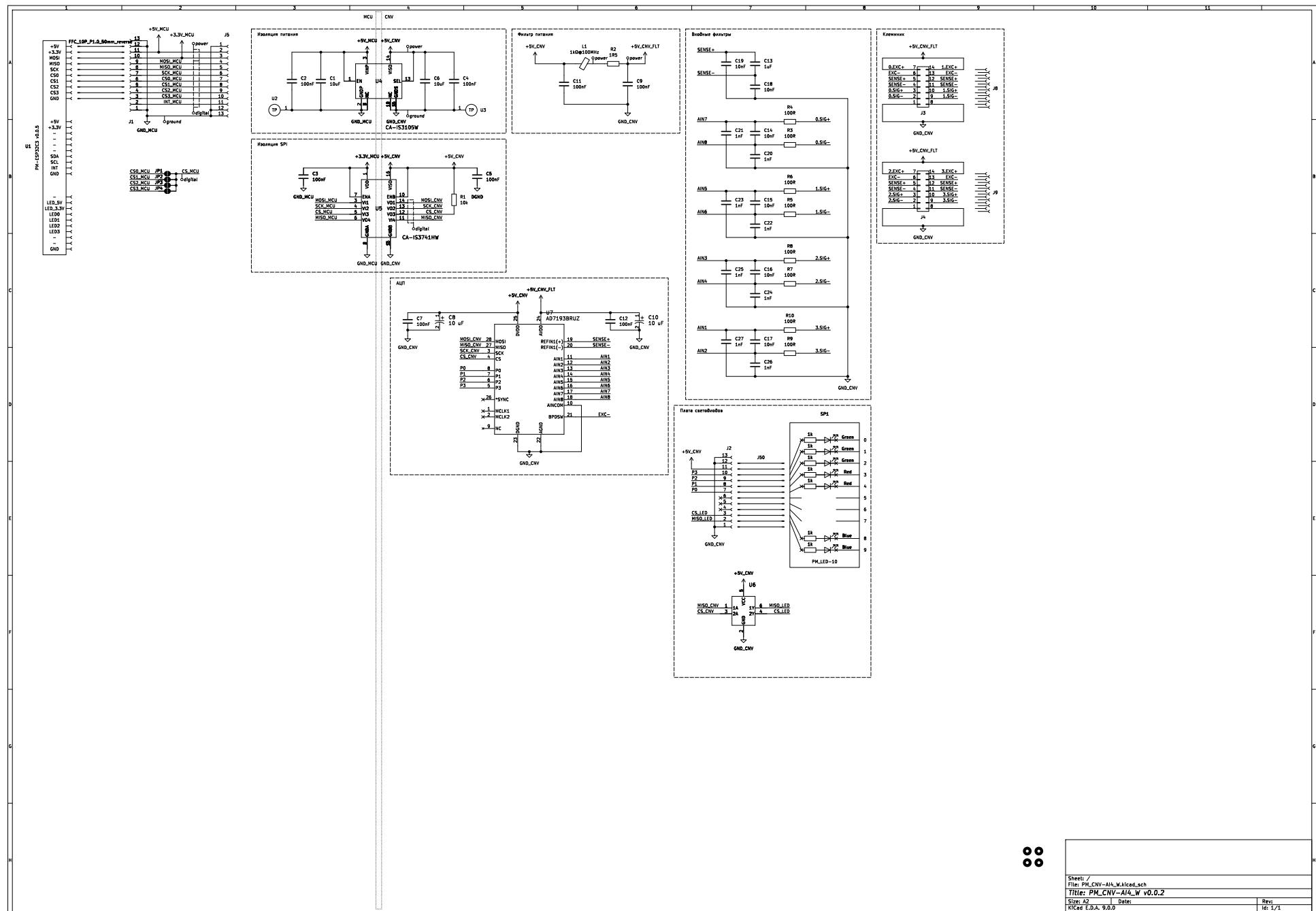


Рис. 21. Принципиальная электрическая схема платы PM_CNV-AI4_W

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1, C6	2	C_10uF_16V_0805_MLCC-X7R
C2, C3, C4, C5, C7, C9, C11, C12	8	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
C8, C10	2	TAJA106M016RNJ
C13	1	C_1uF_16V_0603_MLCC-X7R
C14, C15, C16, C17, C18, C19	6	C_10nF_16V_0603_MLCC-X7R
C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27	8	C_1nF_16V_0603_MLCC-X7R
D1, D2, D3	3	XL-1606SYGC
D4, D5	2	XL-1606SURC
D6, D7	2	XL-1606UBC
J1, J2, J5	3	AFA07-S12FCC-00
J3, J4	2	15EDGRHC-THR-3.5-14P
J8, J9	2	15EDGKNH-3.5-14P
J10	1	FFC_10P_P1.0_50mm_reverse
J50	1	FFC_12P_P1.0_100mm_straight
L1	1	FB_300mΩ_1kΩ@100MHz_1206
R1	1	R_10k_0603_1%
R2	1	R_1R5_0603_1%
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10	8	R_100R_0603_1%
R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17	7	R_1k_0603_1%
SP1	1	PM_LED-10-v0.0.1
U2, U3	2	Keystone_5117
U4	1	CA-IS3105W
U5	1	CA-IS3741HW
U6	1	SN74LVC2G14DBVR
U7	1	AD7193BRUZ

Таблица 19. Перечень элементов платы PM_CNV-AI4_W

**8.12. PM_CNV-AI8_IU - плата аналогового ввода 8 датчиков 0..20 мА
или 0..10 В**

8.12.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

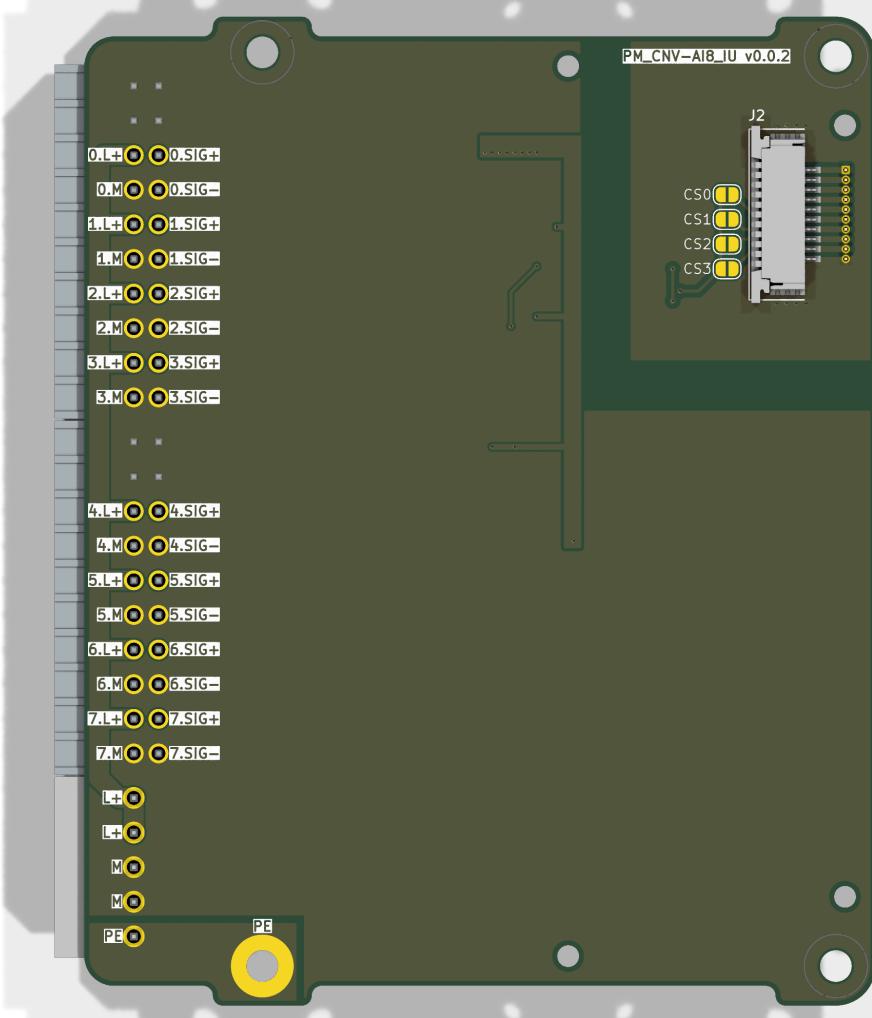
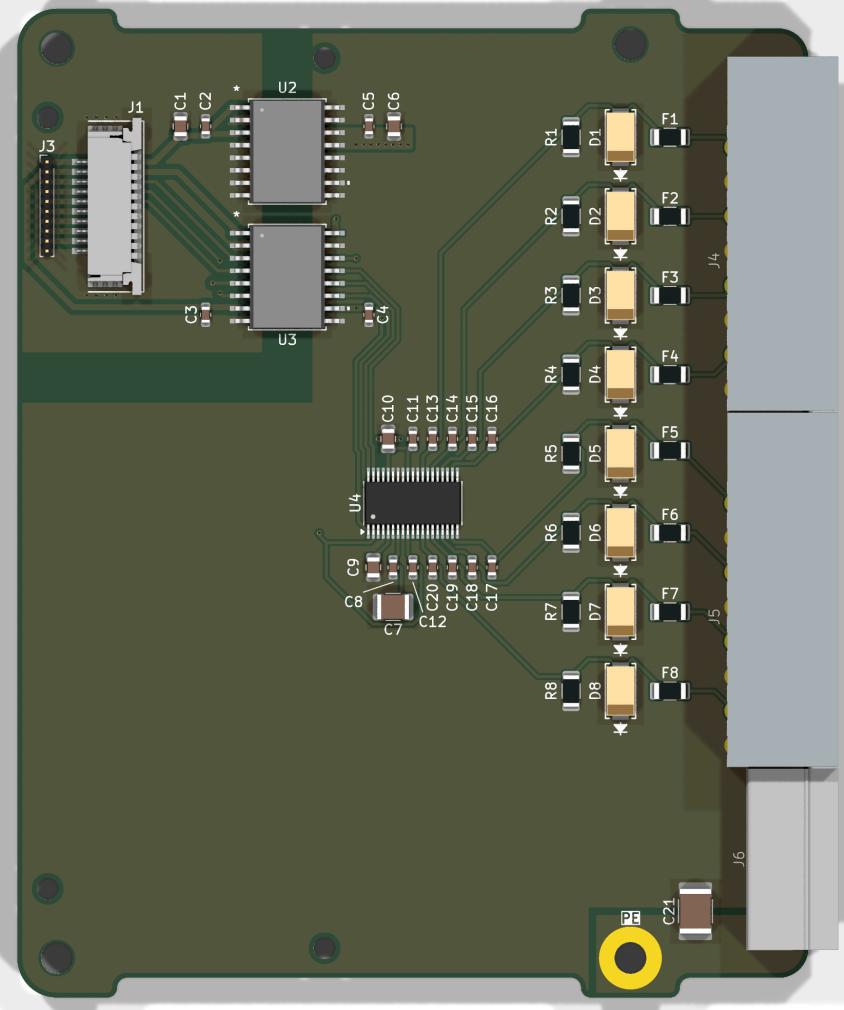


Таблица 20. Внешний вид платы PM_CNV-AI8_IU

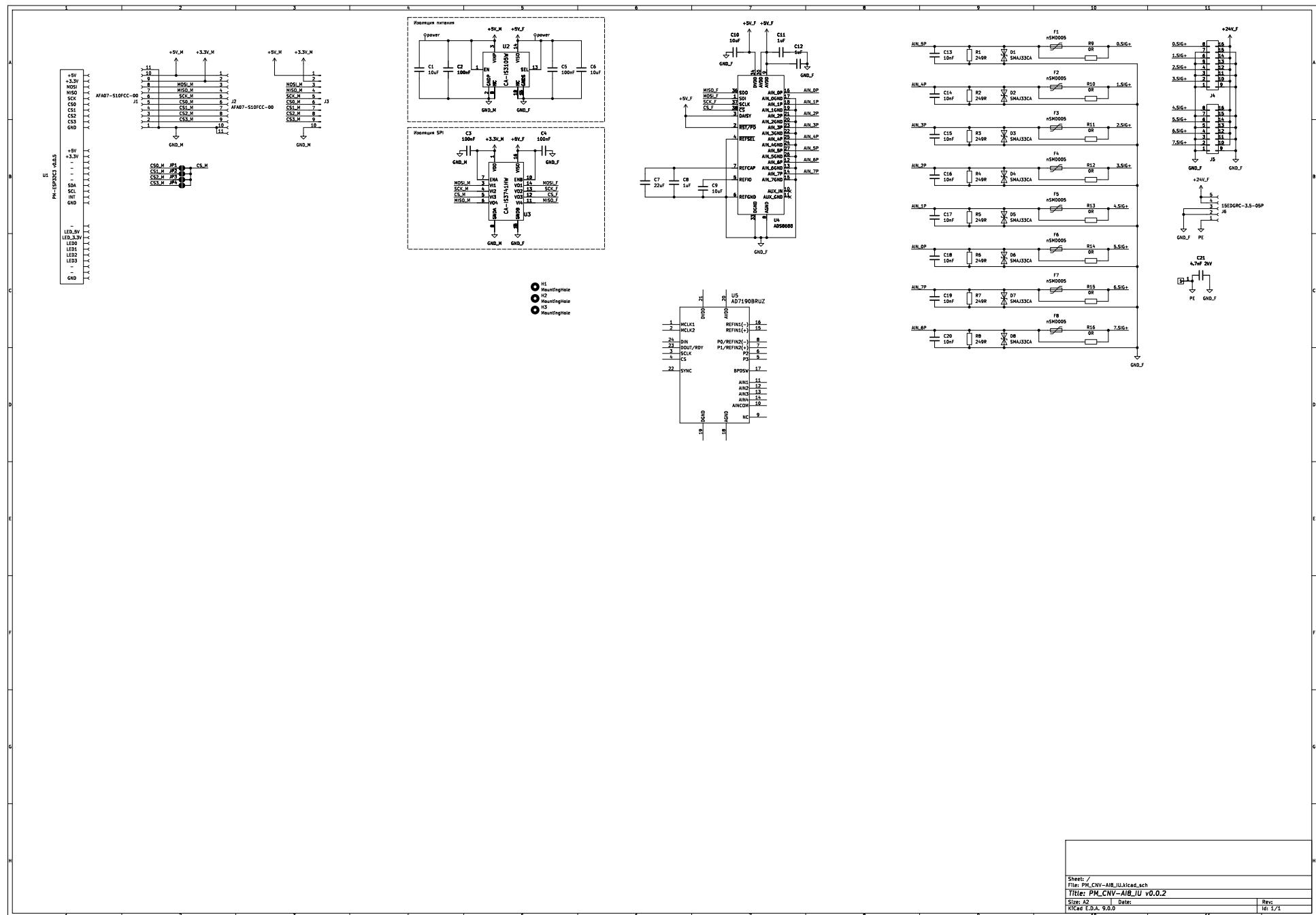


Рис. 22. Принципиальная электрическая схема платы PM_CNV-AI8_IU

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
C1, C6, C9, C10	4	C_10uF_16V_0805_MLCC-X7R
C2, C3, C4, C5	4	C_100nF_16V_0603_MLCC-X7R
C7	1	C_22uF_16V_1210_MLCC-X7R
C8, C11, C12	3	C_1uF_16V_0603_MLCC-X7R
C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20	8	C_10nF_50V_0603_MLCC-C0G
C21	1	C_4.7nF_2kV_1812
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	8	SMAJ33CA
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8	8	nSMD005
J1, J2	2	AFA07-S10FCC-00
J3, U4	2	
J4, J5	2	15EDGRHC-THR-3.5-16P
J6	1	15EDGRC-3.5-05P
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8	8	R_249R_1206_0.1%_25ppm
R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16	8	R_0R_1206_1%
U2	1	CA-IS3105W
U3	1	CA-IS3741HW
U5	1	AD7190

Таблица 21. Перечень элементов платы PM_CNV-AI8_IU

8.13. PM_CNV-AQ - плата аналогового вывода

8.14. PM_HMI-Keyboard

8.14.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

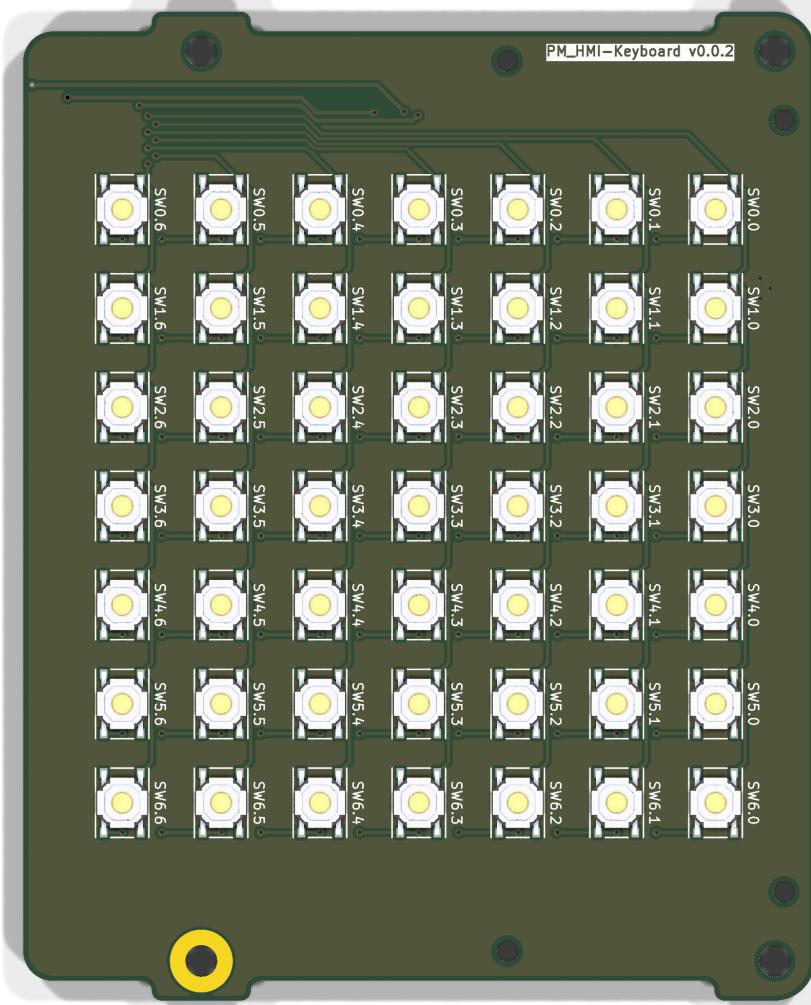
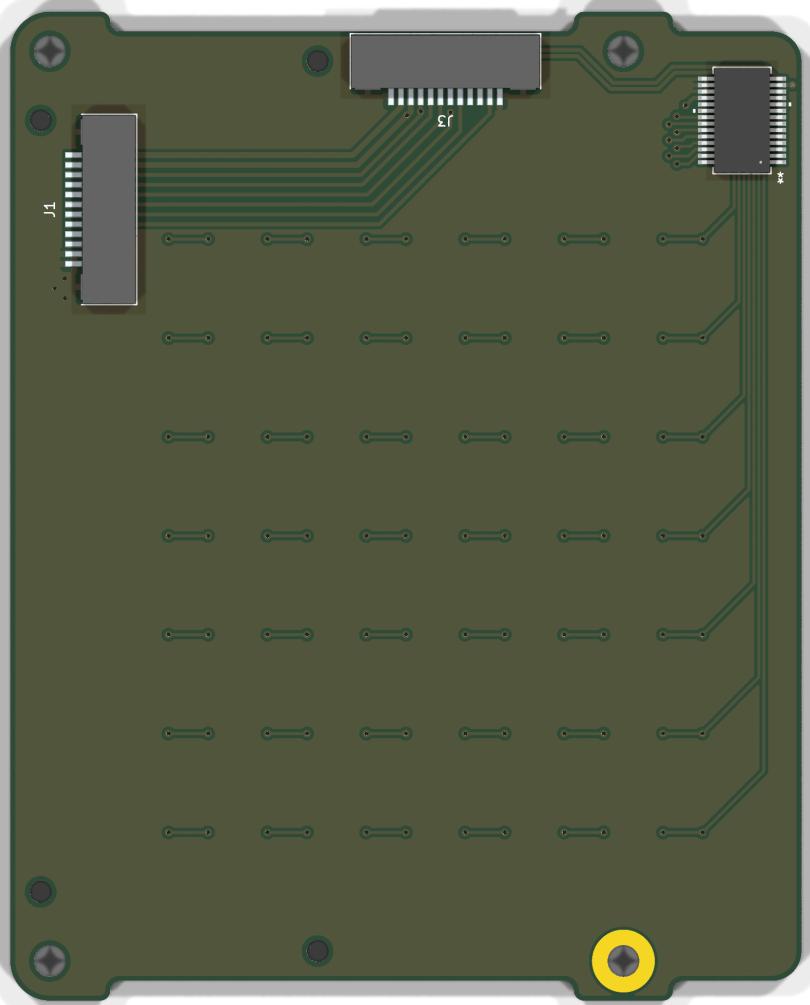


Таблица 22. Внешний вид платы PM_HMI-Keyboard

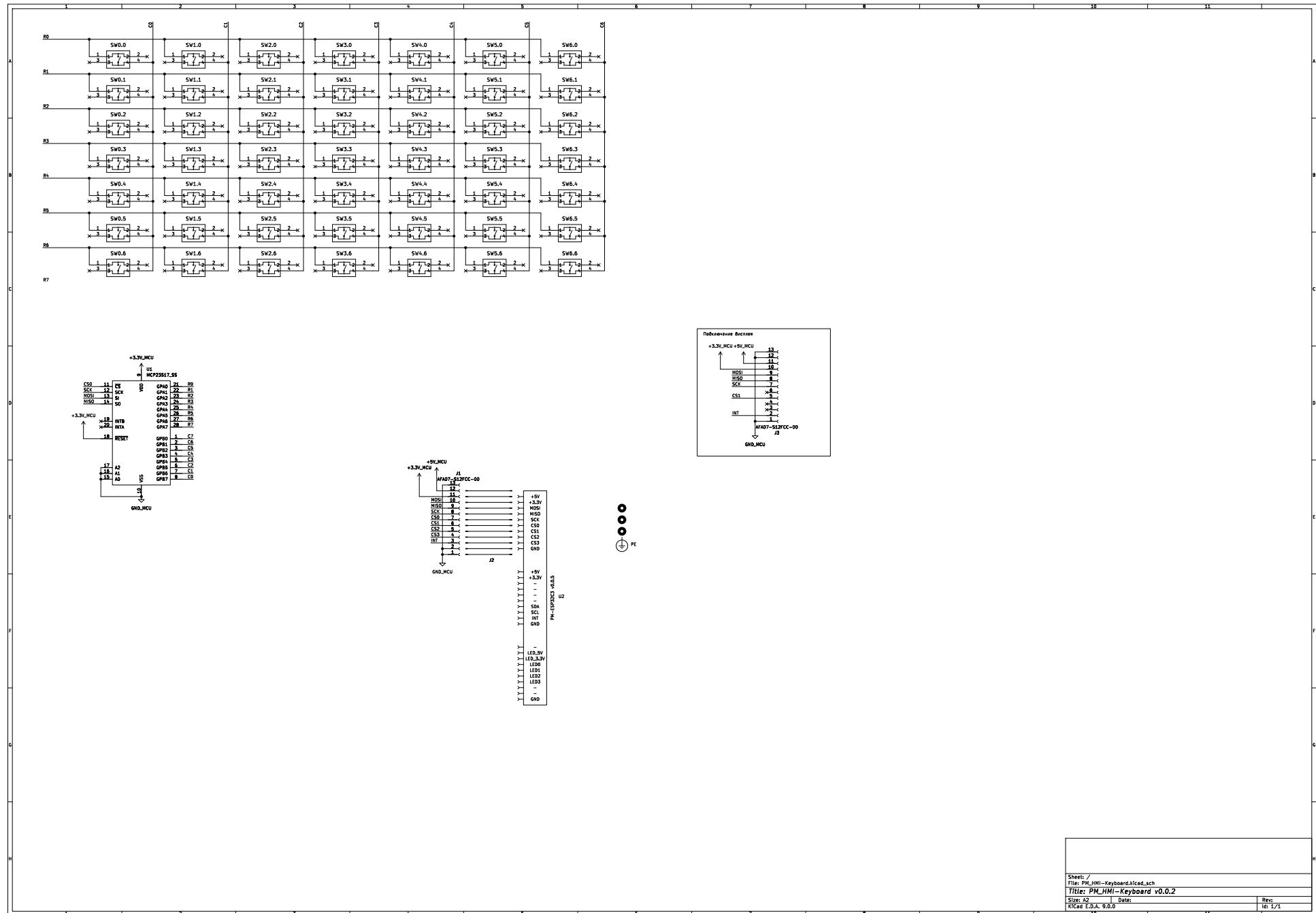


Рис. 23. Принципиальная электрическая схема платы PM_HMI-Keyboard

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
J1, J3	2	AFA07-S12FCC-00
J2	1	FFC_12P_P1.0_100mm_straight
SW0.0, SW0.1, SW0.2, SW0.3, SW0.4, SW0.5, SW0.6, SW1.0, SW1.1, SW1.2, SW1.3, SW1.4, SW1.5, SW1.6, SW2.0, SW2.1, SW2.2, SW2.3, SW2.4, SW2.5, SW2.6, SW3.0, SW3.1, SW3.2, SW3.3, SW3.4, SW3.5, SW3.6, SW4.0, SW4.1, SW4.2, SW4.3, SW4.4, SW4.5, SW4.6, SW5.0, SW5.1, SW5.2, SW5.3, SW5.4, SW5.5, SW5.6, SW6.0, SW6.1, SW6.2, SW6.3, SW6.4, SW6.5, SW6.6	49	TS-1187A-B-A-B
U1	1	MCP23S17-E/SS

Таблица 23. Перечень элементов платы PM_HMI-Keyboard

8.15. PM_HMI-Touch

8.15.1. Внешний вид платы, схема и спецификация

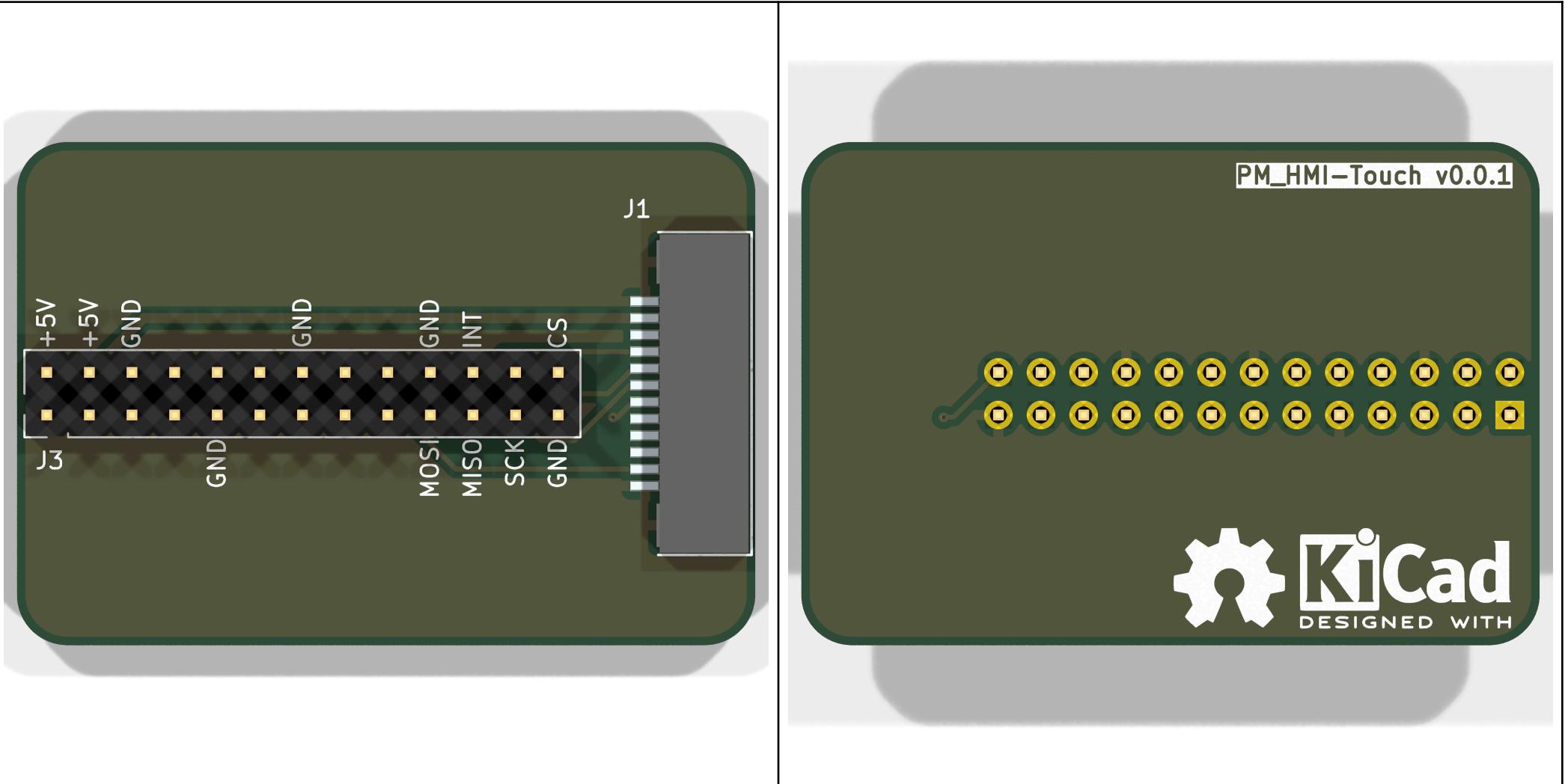


Таблица 24. Внешний вид платы PM_HMI-Touch

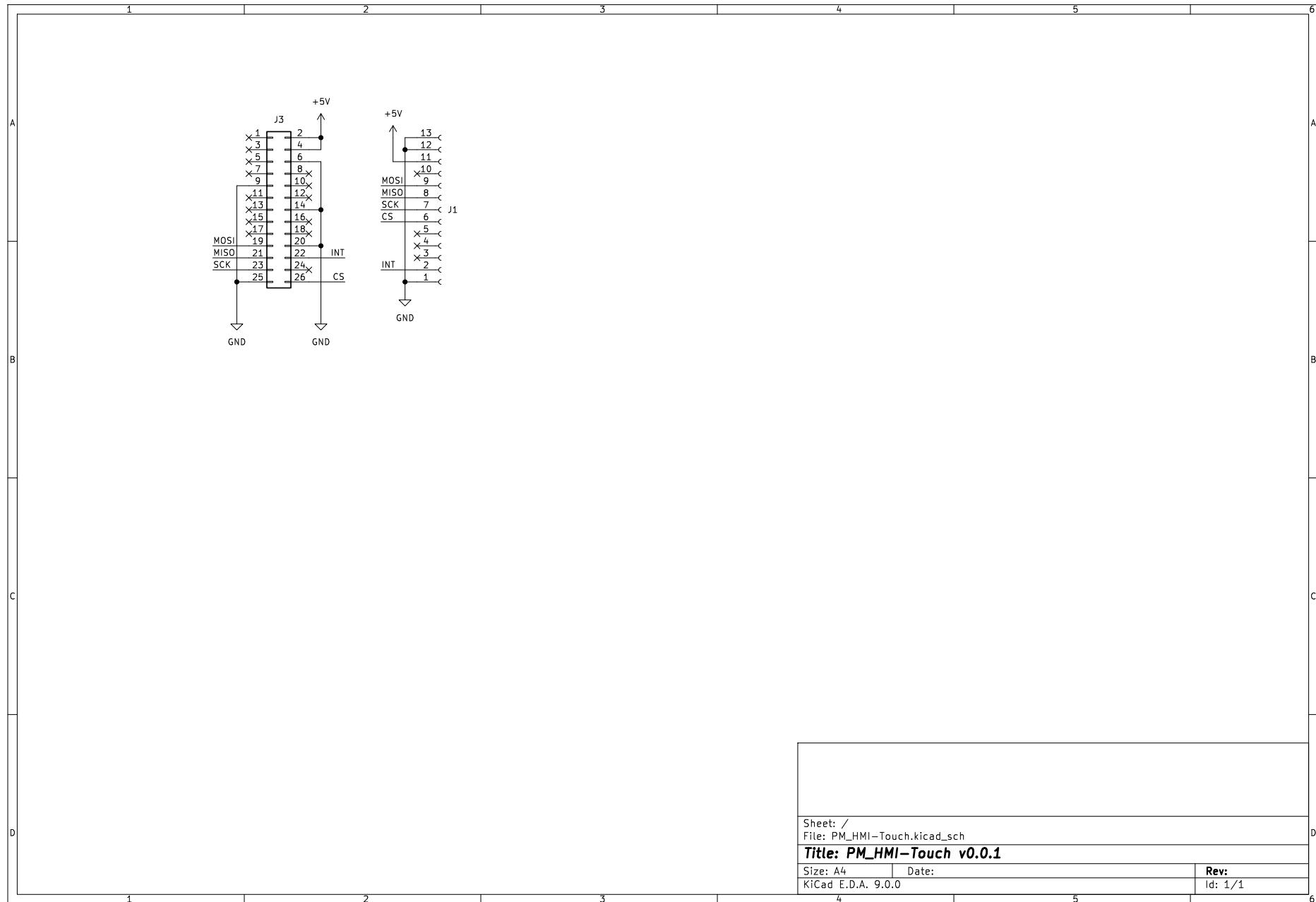


Рис. 24. Принципиальная электрическая схема платы PM_HMI-Touch

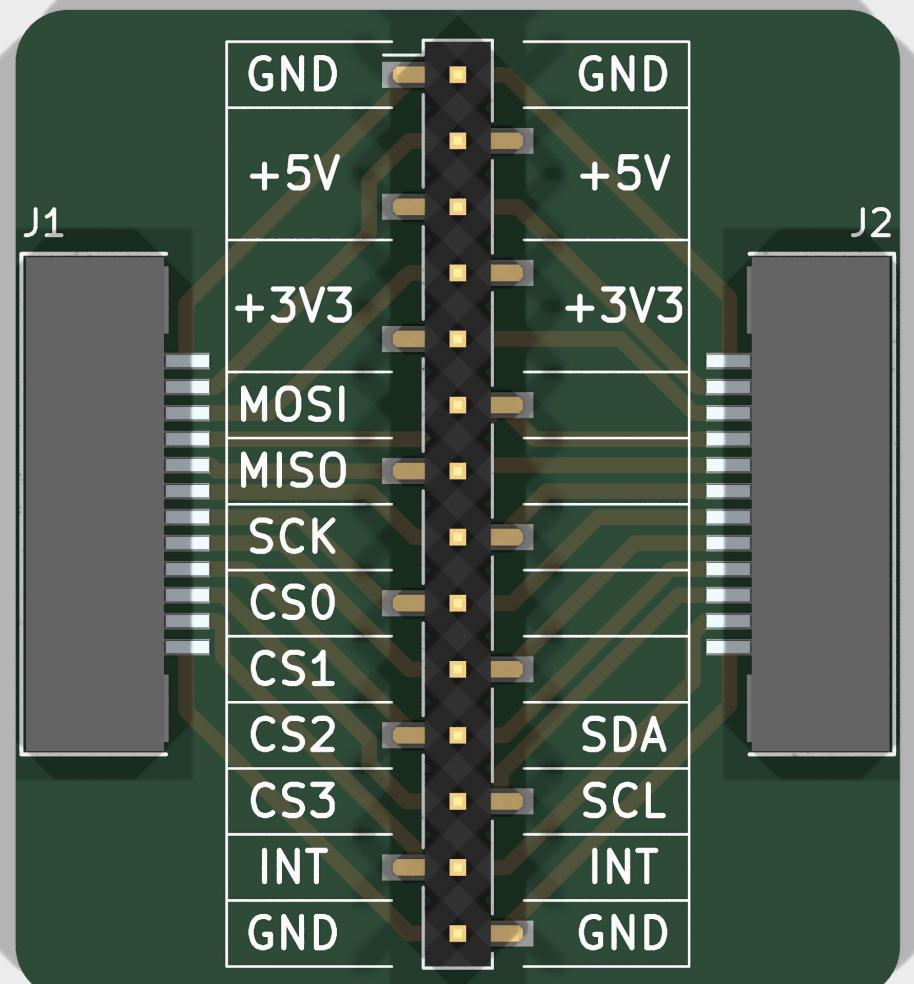
Обозначение	Количе- ство	part_ipn
J1	1	AFA07-S12FCC-00
J3	1	PinHeader_02x13_P2.54_THT_straight

Таблица 25. Перечень элементов платы PM_HMI-Touch

8.16. PM_DBG-FFC

Плата для упрощения отладки. Вставляется в разрыв кабеля FFC между платами. На плате только разъем для подключения осциллографа. Также есть две перемычки (+5V и +3.3V) для возможности измерения потребляемой мощности.

8.16.1. Внешний вид платы, схема и спецификация



PM_DBG-FFC v0.0.2

Таблица 26. Внешний вид платы PM_DBG-FFC

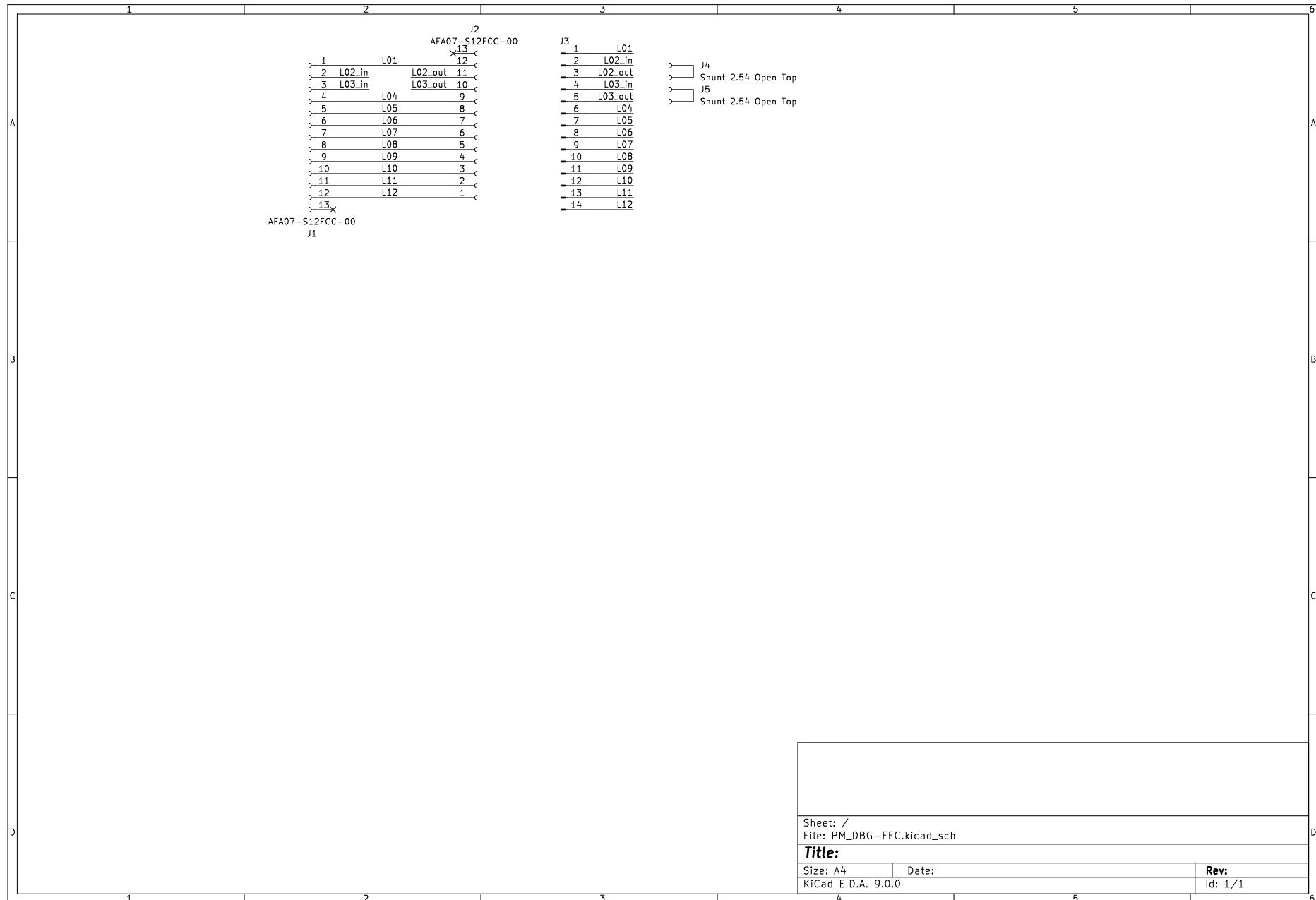


Рис. 25. Принципиальная электрическая схема платы PM_DBG-FFC

Обозначение	Количе- ство	part_ipn
J1, J2	2	AFA07-S12FCC-00
J3	1	PinHeader_01x14_P2.54_SMD_straight
J4, J5	2	Shunt 2.54 Open Top

Таблица 27. Перечень элементов платы PM_DBG-FFC

9. Комбинирование плат в модули

10. Габаритные размеры плат

На рисунке 26 показаны габаритные размеры и отверстия для крепления основных плат. Плату можно крепить к корпусу двумя способами:

- используя 4 отверстия диаметром 3.2 мм
- используя 4 выступа по краям сверху и снизу платы

На рисунке 27 показаны габаритные размеры плат светодиодов PM_LED-10 и PM_LED-18. Плата крепится к основной плате с помощью стоек диаметром 2 мм.

На рисунке 28 показаны габаритные размеры платы микроконтроллера PM MCU-ESP32_C3. Плата крепится к основной плате с помощью стоек диаметром 2 мм.

TODO - нанести диаметры отверстий

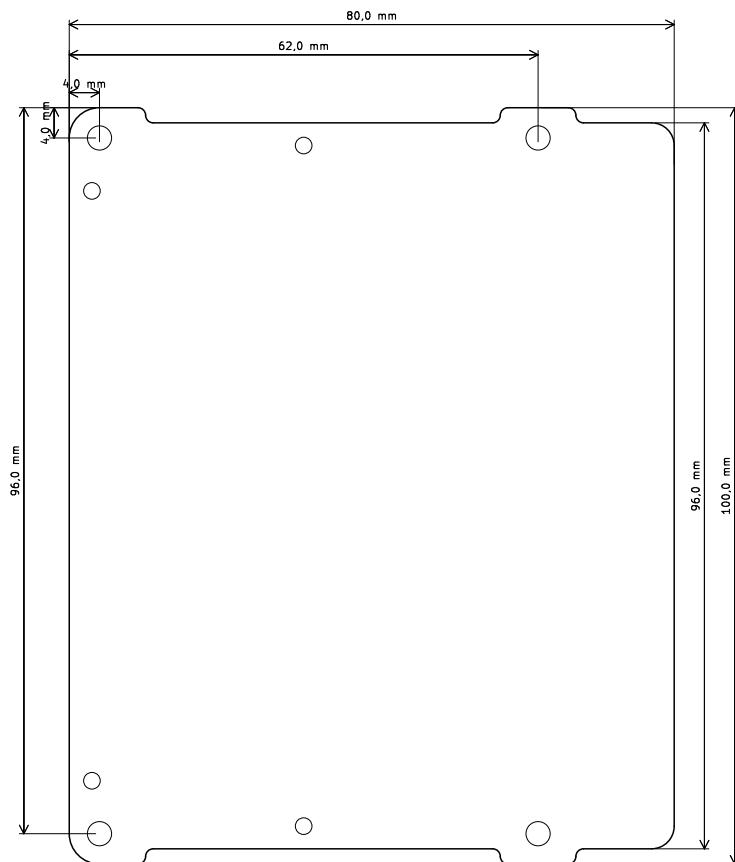


Рис. 26. Размеры основной печатной платы

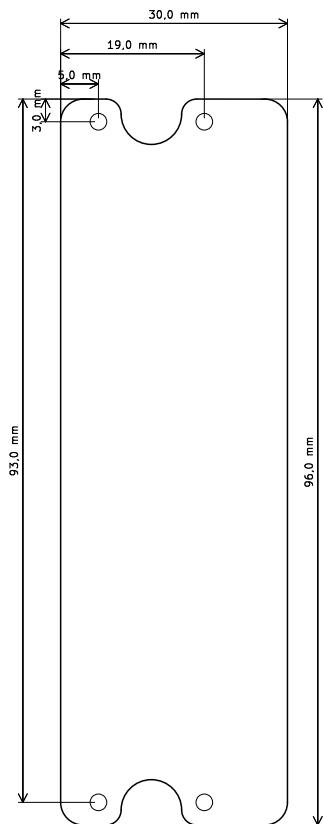


Рис. 27. Размеры платы светодиодов

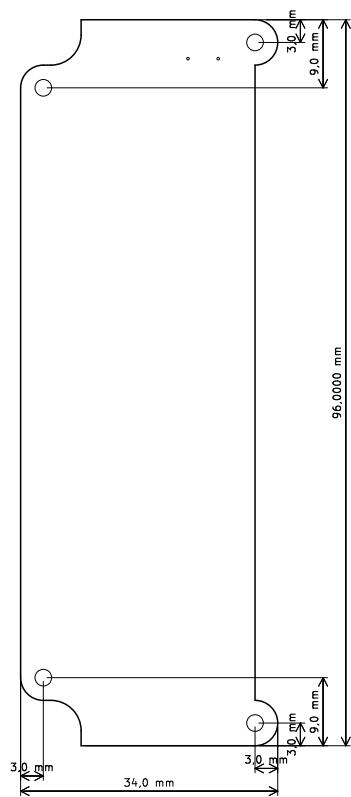


Рис. 28. Размеры платы микроконтроллера

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Anant Kamath, «Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input Modules», окт. 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.ti.com/lit/wp/slla529/slla529.pdf>
- [2] Anant Kamath, «How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial systems», сен. 2017. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.ti.com/lit/an/slyt725/slyt725.pdf>
- [3] Texas Instruments, «How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System», май 2021. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.ti.com/lit/ab/slla416c/slla416c.pdf>
- [4] Texas Instruments, «Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications», ноя. 2022. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.ti.com/lit/po/sloa327a/sloa327a.pdf>
- [5] Shanghai Chip analog Microelectronics Co., «CA-IS309x 5kVRMS Isolated RS-485 Transceivers with Integrated DC-DC Converter», 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://e.chipanalog.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20250305/CAIS30923098datasheetVersion1.13en20241216.pdf>
- [6] Shanghai Chip analog Microelectronics Co., «CA-IS398x Isolated Octal Industrial Digital Input», 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://e.chipanalog.com/Public/Uploads/uploadfile/files/20240611/CAIS398XdatasheetVersion1.09en.pdf>
- [7] Espressif Systems, «ESP32-C3-WROOM-02/02U», 2024. [Онлайн]. Доступно на: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf
- [8] Analog Devices, «Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA». [Онлайн]. Доступно на: <https://www.analog.com/en/resources/reference-designs/circuits-from-the-lab/cn0102.html#rd-overview>